



产品采购指南

半导体

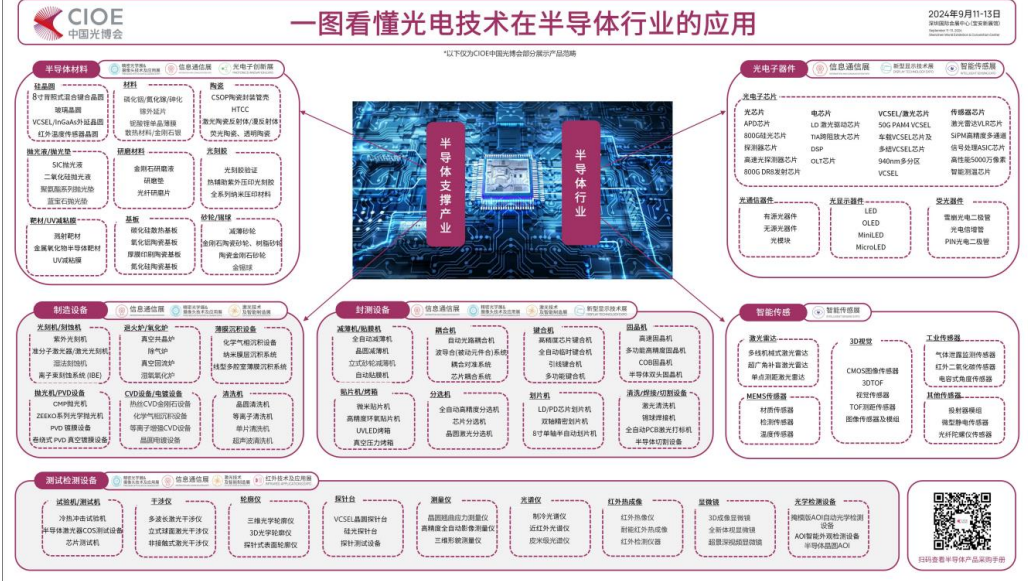
第25届中国国际光电博览会

2024年9月11-13日 深圳国际会展中心(宝安新馆)



扫码免费领取门票

半导体产业链图&展期相关会议



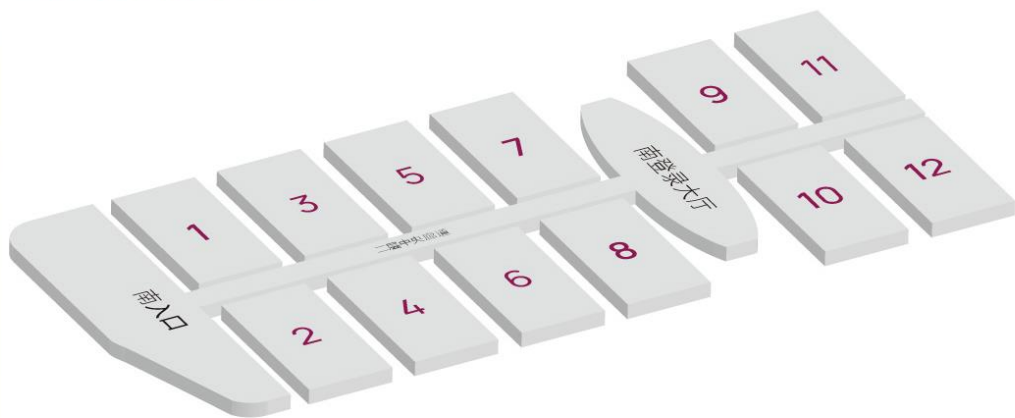
点击查看可查看并下载原图:

<https://guanwang.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/images/Semiconductor.pdf>

时间	地点	会议名称
2024/09/11下午	2号馆二楼2C	激光器件趋势论坛—产业整合，高质量发展
2024/09/11 下午	6号馆二楼6A	先进红外材料与器件论坛
2024/09/11 下午	6号馆二楼6C	2024智能传感器技术与创新应用高峰论坛
2024/09/11 下午	7号馆馆内会议室	第四届机器视觉在工业机器人的应用
2024/09/11 下午	11号馆馆内会议室	光电产业高峰论坛--光电“芯”未来
2024/09/12 上午	1号馆二楼1C	新一代半导体制程工艺技术论坛—光刻与纳米压印技术进展
2024/09/12 下午	4号馆馆内会议室	超快激光微纳加工制造论坛
2024/09/12 下午	5号馆二楼5A	CIOE与Yole Group 光电化合物半导体论坛
2024/09/12 全天	9号馆二楼9C	光电子集成芯片设计及制造、封装技术论坛

* (以上仅为部分会议, 实际名称以现场为准)

主题展馆分布图



9号馆

信息通信展

综合布线馆

光器件
光纤光缆/电线电缆
FTTX新一代光纤网络
数据中心
车载以太网

10号馆

信息通信展

半导体及光通信智能装备馆

测试测量/仪器仪表
信息传输设备
封装设备
半导体生产与制造

11号馆

信息通信展

通信器件模块馆

芯片设计
化合物半导体/光芯片/元器件
组件/模块
汽车光通信

12号馆

信息通信展

通信器件模块馆

芯片设计
化合物半导体/光芯片/元器件
组件/模块
汽车光通信

1号馆

精密光学展& 摄像头技术及应用展

摄像头技术及应用馆
光学镜头
摄像模组
摄像头智能化AA设备

3号馆

精密光学展& 摄像头技术及应用展

摄像头技术及应用馆
光学测量测试
光学模造非球面技术展区
蓝宝石加工、应用
机器视觉及工业自动化

5号馆

精密光学展& 摄像头技术及应用展

精密光学加工馆
超精微纳加工
光学元件
光学材料
光学加工设备

7号馆

精密光学展& 摄像头技术及应用展

光学真空镀膜馆
光学镀膜材料
功能薄膜、镀膜元件
光学镀膜设备区

2号馆

激光技术及智能制造展 新型显示技术展

激光设备
智能装备与自动化
手持激光焊
钙钛矿展示区
显示材料/面板/模组
显示制造装备
AR/VR产品及创新应用

4号馆

激光技术及智能制造展

激光材料与元件
激光模组
激光器
激光配套及周边
激光医疗美容展示区

6号馆

智能传感展 光电子创新展

激光雷达
3D视觉与成像
工业传感器及测量
MEMS及传感器
科研院所、高校及专精特新企业

8号馆

红外技术及应用展

红外热成像技术及应用
红外测温材料
红外传感器
紫外技术及应用
红外测试测量

产品类型	同期展会	页码
半导体材料		
晶圆	光电子创新展/精密光学展/红外展	8
陶瓷	信息通信展/精密光学展/激光及智能制造展	9
靶材 / UV减粘膜	精密光学展/新型显示展/信息通信展	10
抛光液	精密光学展/红外展	11
砂轮	精密光学展/激光及智能制造展/信息通信展	12
研磨垫	精密光学展/信息通信展	13
基板	光电子创新展/激光及智能制造展	14
光刻胶/键合胶	光电子创新展/新型显示展/激光及智能制造展/精密光学展	15
模具材料 / 焊料	精密光学展/信息通信展	16
其他半导体材料	信息通信展/精密光学展/激光及智能制造展	17
半导体配套产品	信息通信展/精密光学展/激光及智能制造展	18
半导体设备		
光刻技术/光刻机	光电子创新展/传感展/精密光学展/激光及智能制造展	20-21
键合机	信息通信展/激光及智能制造展/红外展	22
固晶机	信息通信展	23-24
试验机 / 芯片测试机	信息通信展	25
贴片机	信息通信展	26-28
减薄机 / 贴装装备	信息通信展/精密光学展/光电子创新展	29
抛光机	精密光学展/光电子创新展	30

产品类型	同期展会	页码
研磨机	精密光学展/激光及智能制造展/信息通信展	31
清洗机	精密光学展/信息通信展/激光及智能制造展	32
划片机	精密光学展/信息通信展/激光及智能制造展	33
光谱仪	激光及智能制造展/精密光学展	34
蚀刻机 / 等离子去胶机	精密光学展/信息通信展	35
切割设备	激光及智能制造展/信息通信/精密光学展	36
钻孔设备	激光及智能制造展/精密光学展	37
显示设备	新型显示展	38
检测设备	激光及智能制造展/信息通信展	39-41
轮廓仪	精密光学展	42
测量仪	信息通信展/精密光学展/智能传感展	43
固化设备	精密光学展/信息通信展	44
真空镀膜设备	精密光学展/新型显示展	45
焊接设备	激光及智能制造展/信息通信	46
探针台	信息通信展/智能传感展	47
耦合机	信息通信展/激光及智能制造展	48-49
其他半导体设备	信息通信展	50
光电子器件		
光芯片	信息通信展	52
电芯片	信息通信展	53
传感器		
工业传感器	智能传感展	55
MEMS传感器	智能传感展/红外展	56

相关主题指南推荐——智能制造

更多产品采购指南——
智能制造、数据中心、
安防、消费电子、医疗、
智能汽车、科研院所、
绽放科研之光



重点推荐您查阅【智能制造】产品采购指南，产品内容包含：

生产制造设备

- 1) 激光制造：激光加工设备、智能装备与自动化、工业机器人
- 2) 光学加工制造：光学加工设备、摄像头生产设备
- 3) 光学镀膜：光学镀膜设备、光学镀膜材料
- 4) 新型显示：显示制造装备

测试测量及检测

光学测量仪器、缺陷检测设备、传感测试测量仪器、红外测试测量仪器、光通信仪器仪表

核心器件

激光雷达、激光器、
工业传感器、工业相机、
镜头&模组、机械加工及数控



扫码下载智能制造指南电子版



重点展示半导体材料

展示范围：晶圆、陶瓷、靶材 /UV减粘膜、抛光液、砂轮、研磨材料、基板、光刻胶/键合胶、模具材料、半导体材料、半导体配套产品

晶圆

广州绿晶玻璃有限公司

5B82

玻璃晶圆

我司可提供各尺寸厚度及多种材质的玻璃晶圆，具有出色的透光性能、良好的化学稳定性、较高的面型精度及表现质量，符合常规的加工要求和工业标准（SEMI等），主要应用于微光学、MEMS、晶圆级封装、阳极键合、TGV以及各种指定应用。



半导体材料

深圳市唯锐科技有限公司

8B16

VIGO公司III-V族
/VCSEL/InGaAs外延晶圆

波兰VIGO公司成立于1993年，拥有一支超过30年红外探测器研究经验的资深专家队伍，是MCT/InAs/InAsSb探测器的领先设计者和制造商，提供低温制冷的红外探测器、III-V族外延片，覆盖1-16 μ m光谱范围，同时提供探测器模块、前置放大器、TEC温控等组件和解决方案。提供VCSEL晶圆和InGaAs晶圆。

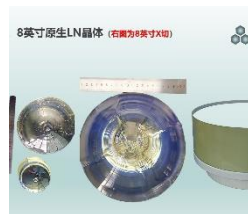


苏州匀晶光电技术有限公司

4D225

3~8 英寸铌酸锂晶圆片

3~8英寸 铌酸锂 晶体及晶圆 3~6英寸 $MgO:LiNbO_3$ 晶体及晶圆 3~4英寸 掺杂铌酸锂晶体及定制化晶圆。



浙江罗克光电科技股份有限公司

3A63

衬底及封装级玻璃晶圆

提供各尺寸各厚度玻璃晶圆，广泛应用于半导体、消费电子、生物医药、基因检测、5G通讯和无人驾驶等多个领域。



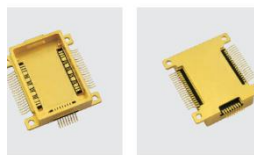
陶瓷

合肥伊丰电子封装有限公司

12C77

陶瓷类管壳

作为第三代真空器件管壳材料，陶瓷管壳可广泛用于光通信、激光器、红外探测器、混合集成电路器件、微波通信等领域。



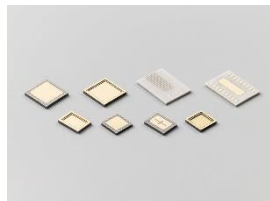
半导体材料

株洲艾森达新材料科技有限公司

11B11-2

HTCC

高温共烧陶瓷即为HTCC(High-temperature co-fired ceramics)，主要以氧化铝或化铝生瓷带和、组、等高点金属浆料为主要原料，通过丝网印刷的方式将浆料印周在生瓷带上构成金属电路，并采用通孔填孔的方式使上下层导通，再进行多层叠合和高温烧结(其中氧化铝HTCC烧结温度在1500以上，氮化铝HTCC烧结温度在1800以上)，最后经过电镀、烧焊等工艺，形成一个三维布线系统的单片结构，具有耐腐蚀、耐高温、寿命长、高效节能、温度均匀、导热性能良好、热补偿速度快等优点。

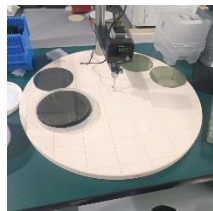


萍乡顺鹏新材料有限公司

4D188、4D189

氧化铝陶瓷盘

PIBM自发凝固成型技术是氧化铝高端产品制造最前沿的技术，利用该技术可生产各种不同高端市场需求的新材料。



有研资源环境技术研究院（北京）有限公司 7B33

陶瓷靶材

可用于制备透明导电薄膜、各类光学薄膜、固态电解质薄膜、热障涂层、可燃毒物涂层、吸气薄膜、耐磨防护涂层、相变存储薄膜等，提供各种高纯、高密度氧化物，硅化物，碳化物，硫化物，硼化物，氟化物，难熔金属合金，贵金属合金，复合陶瓷化合物等，应用于平板显示、集成电路、全固态锂离子电池、电真空、功能涂层、相变存储器件等领域的研发及生产。



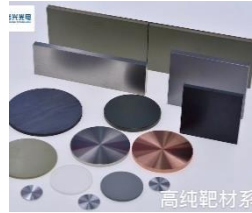
靶材/UV减粘膜

福州市诺兴光电材料有限公司

7B29

高纯金属靶材

我司生产并销售高纯磁控溅射领域的贵金属靶材、金属靶材、合金靶材、陶瓷靶材、定制化掺杂靶材、特殊功能靶材等。



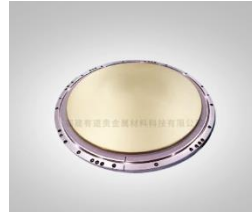
半导体材料

福建有道贵金属材料科技有限公司

7E41

金靶

有道可提供多行业使用金靶，金靶纯度包含4N/5N，晶粒尺寸可稳定控制在100um以内，均匀且细腻的微观组织可以保证极佳的镀膜效果。同时提供靶材绑定及回收服务，绑定焊合率可控制在97%以上。客户使用的金残靶可回收再利用用于置换新靶材避免受黄金价格波动影响成本。靶材出货前会经过纯度/晶粒/焊合率/内部缺陷/尺寸/表面粗糙度等多项检测确认合格后确保客户使用过程的稳定。



北京有色金属与稀土应用研究所有限公司

12C62

高纯贵金属溅射靶材

高端气相沉积镀膜材料，主要用于微电子产业，高纯金属制造用于尖端技术的各种薄膜材料。



郑州磨料磨具磨削研究所有限公司

5C25

UV减粘膜

UV减粘膜是一种特种胶带，其常态下具有很强的粘性，经UV光照射后粘性急剧降低，通常用于工件研磨、切割等制程的支撑及保护。



抛光液

大连国茂材料科技有限公司

5C62

日本Baikowski抛光液

Baikowski 提供多种抛光浆料。可应用于氟化钙、氟化钡、硒化锌、硫化锌、铈酸锂、锗、硅等晶体。HK系列的金金刚石抛光液针对于氮化镓和 碳化硅晶圆片的抛光进行了优化处理。快速的去除率，优秀的表面光洁度。Baikowski 将会在抛光浆料的选择上提供帮助，并根据您的需要进行抛光浆料的定制。



包装方式：
20KG 桶装，
4KG 瓶装

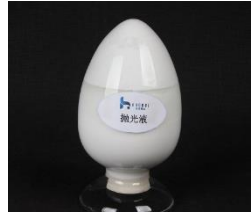
半导体材料

包头市昊锐稀土有限公司

510

抛光液

适用于盖板玻璃，硬盘玻璃，触摸屏，蓝玻璃，光学玻璃等的高性能抛光。



宁波日晟新材料有限公司

5A31

硅片抛光液

SHINEPOL硅片抛光液是一系列优质稳定的硅片抛光耗材。该系列产品根据客户工艺特性对标不同的抛光液产品。采用严格的粒径控制与配方，通过自主开发的化学增强抛光原理，统筹抛光液流变性能，对硅片表面显示出高效的抛光速度、优质的抛光表面（粗糙度低，划伤低）。该产品固含量低、效率高、不易结晶、应用操作简便、抛光表面易清洗、对抛光设备无腐蚀、抛光液在抛光机以及抛光垫上无沉积。



瑞迈迪新材料科技（苏州）有限公司

3A70

OPTIQ 抛光液

在精密玻璃工件的光滑度、划痕/凹坑、表面光洁度和消除次级表面损伤方面，ULTRA-SOL® OPTIQ的工艺性能均超过了行业规范的要求。独特的化学成分使得该磨料的均匀永久性悬浮液得以实现，从而实现了一致且可重复的优秀表面光洁度，以及在生产环境中的易用性。



砂轮

郑州三泰金刚石砂轮有限公司

5D55

金刚石减薄砂轮

金刚石减薄砂轮根据结合剂不同分为以下几种：1.树脂结合剂金刚石减薄砂轮、2.金属结合剂金刚石减薄砂轮3.陶瓷结合剂金刚石减薄砂轮，主要应用于蓝宝石、硅片、玻璃、陶瓷等脆性材料的单、双面减薄磨削。



半导体材料

郑州磨料磨具磨削研究所有限公司

5C25

LED背减薄砂轮

用于LED行业外延片背减薄加工，稳定配套日本、韩国、台湾主流研磨机，可加工2寸、4寸、6寸外延片。减薄效率高，表面质量好。砂轮质量稳定，不易深刮、碎片。砂轮寿命高，具有极高性价比，可大幅降低单片加工成本。砂轮主要性能已达到或超过进口同类产品水平。



上海号角精密工具有限公司

10B108-10B110

SiC减薄砂轮

应用场景：硅晶圆，SiC晶圆，氮化镓，铌酸锂等材料的减薄磨削 性能优势 *微气孔陶瓷结合剂实现高效磨削 *精筛磨料粒度，获得低损伤和良好的表面质量 *多种粒度，多种结合剂可选择，满足不同材料和不同精度产品加工要求 *响应速度快，快速迭代新材料磨削方案。



昆明龙誉恒光电辅料有限责任公司

5C31

筒形砂轮

用途：用于光学玻璃镜片的粗磨削加工，去除玻璃表面硬质层，并加工出所需面形。特性：切削性非常好、加工效率高、自锐性好、稳定性强；规格：磨料层外径（D） $\phi 4\text{mm} \sim \phi 100\text{mm}$ ；内径（D1） $\phi 2\text{mm} \sim \phi 96\text{mm}$ ；高度（H）：5mm~ $\phi 10\text{mm}$ 金刚石粒度：35#~400#；注：外径、内径、高度、底座均可按客户要求来进行订制。



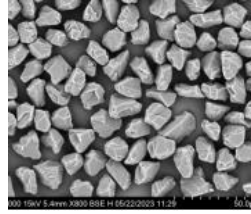
研磨材料

柘城县施诺德钻石科技有限公司

7E07

晶密®精加工研磨用
金刚石微粉系列

原料采用自锐性好的RVD金刚石，TI检测结果稳定。采用特殊的破碎整形加工工艺，晶型呈较规则块状，饱满度高，片状率低、长径比小，棱角突出，粒度分布较为集中，大颗粒控制严格，加工精度高。产品的强度检测和磨削效率检测结果稳定，能满足大部分应用场景，是一种性价比高的精加工研磨用金刚石微粉。适用于制作树脂或陶瓷结合剂制品，金刚石聚晶，研磨液等，用于精加工研磨硬质合金、陶瓷零件，蓝宝石，半导体，玻璃，钻石，石材等。



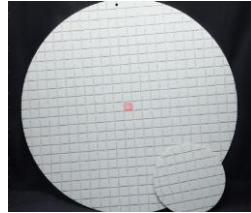
半导体材料

东莞励治研磨科技有限公司

3B82

CMP研磨垫

SUBA(白垫)，具有高移除率，高平坦性，低缺陷性与高性价比等优势。因具有特殊微孔结构，对研磨液具备优良保持性，同时因研磨垫具有适度之刚性以及良好的研磨再现性，可提升制程的稳定性与尺寸精密度。适用于半导体，光学元件、晶体、金属和玻璃材料的终道抛光。也可用来抛光特殊材质、硅、锗、砷化镓、陶瓷等产品。



深圳市新誉通光电有限公司

9C93

超精密研磨抛光材料

公司主要研发、生产及销售金刚石，碳化硅，氧化铝，氧化铈，氧化硅研磨抛光片，植绒布，研磨抛光带及光纤研磨液，研磨油等产品。产品广泛应用于光通讯行业各种连接器，组件的研磨抛光；微电机行业微型马达的换向器抛光；制辊行业各种镜面辊，网纹辊，陶瓷辊，碳化钨辊的研磨抛光；汽车行业的发动机曲轴抛光，TFT-LCD面板抛光等需要精密加工的领域。

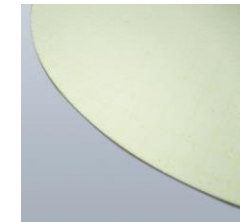


深圳中机新材料有限公司

3C81

聚氨酯抛光垫

原料使用一种特殊的聚氨酯材料，该材料含有很多非常细小均匀的气孔、表面平整度极好、耐用性佳、且抛光加工时划伤少。聚氨酯精磨垫具有耐磨性好、使用周期长、耐高温等特点。可背胶、开槽、压纹等优势。可配合团聚金刚石研磨液或聚晶金刚石研磨液使用。



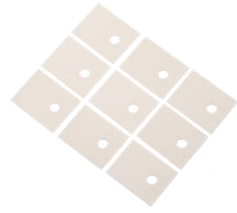
基板

福建华清电子材料科技有限公司

11D829

高热导氮化铝陶瓷基板

高导热率，优良的绝缘性能，热膨胀系数与Si相近，低介电常数，耐热、耐熔融金属的侵蚀。



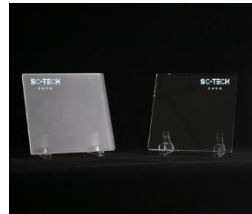
半导体材料

上海菲利华石创科技有限公司

5A01

光掩膜基板

光掩膜版是微电子加工技术常用的光刻工艺所使用的图形模板，功能类似于传统照相机的“底片”，是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体，FPD及IC领域高精度光掩膜版需要使用石英玻璃作为基板材料。我司已具备高世代FPD用及IC用高精度光掩膜石英基板生产能力。FPD掩膜版基板最大尺寸已至1620*1780mm，TTV要求20μm以下，表面无2μm以上缺陷；IC掩膜版基板是固定152*152mm的小尺寸基板，但PV要求在百纳米级别，表面无百纳米级别缺陷。



宁波荣宝雨半导体有限公司

4E050

陶瓷基板

产品特点 1.透过专利设计的热沉载板,可有效改善散热不均及偏振角问题。 2.批次监控镀铜研磨厚度,可达20um。 3.金属剥离测试可达10Mpa(380k/2分钟)。



株洲艾森达新材料科技有限公司

11B11-2

氮化硅基板

Si3N4陶瓷基板具备高强度、高导热、耐高温、高耐磨性、抗氧化、热膨胀系数低和抗热震等性能，同时具有较好的气密性，可隔离水汽、氧气和灰尘等特点，成为大功率半导体器件基板的最佳材料，被广泛应用到功率集成电路中。氮化硅基板与氮化铝和氧化铝基板相比，具有两倍以上抗弯强度、与氧化铝和ZTA基板相比具有三倍以上的热导率、具有高的绝缘性和与Si相匹配的热膨胀系数、优异的抗热震性能和高强度。



光刻胶/键合胶

璞璘科技（杭州）有限公司

2A117

全系列纳米压印材料

全系纳米压印材料：模板胶、子模板（工作模板）胶、热固化纳米压印光刻胶、刻蚀型紫外光固化纳米压印光刻胶、光学性能紫外光固化纳米压印光刻胶、力学性能紫外光固化纳米压印光刻胶、生物医学紫外光固化纳米压印光刻胶、喷墨打印型紫外光固化纳米压印光刻胶材料、表面处理材料：防粘剂、增粘剂等。



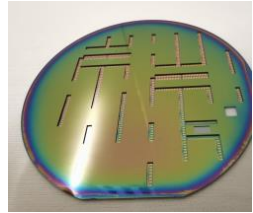
半导体材料

西安励德微系统科技有限公司

6C138、6C139

特殊材料键合

工艺解决方案：特殊材料晶圆键合 关键参数：键合温度 $>400^{\circ}\text{C}$ 、压力 $>25000\text{N}$ 应用场景：硅硅直接键合、石英键合、蓝宝石键合、玻璃键合、多层阳极键合MEMS器件、晶圆级封装、真空场景传感器。



苏州光舵微纳科技股份有限公司

2B102

纳米压印耗材

苏州光舵微纳科技成立于2011年，致力于推动纳米压印设备及技术的研发和产业化应用，是一家可以提供纳米压印设备、材料、工艺方案及技术支持一整套解决方案的科技公司，也是国内纳米压印技术产业化应用的领先企业。1.系列化的纳米压印模具胶水 2.系列化的纳米压印刻蚀胶 3.系列化纳米压印光学胶水。



德路工业粘合剂（上海）有限公司

3A40-9

微透镜压印材料

DELO 光学级聚合物，如DELO KATIOBOND OM6616，适用于大规模微透镜复制，它们具有高透明度、甚至在回流焊过程中也具有出色的光学稳定性以及优异的加工性。微型透镜在小型化光学设备中必不可少，它们可作为成像元件，也可用于增加光学效率。



模具材料/焊料

东莞壹德贸易有限公司

1D02

碳化硅或是金屬陶瓷複合材料SS系列製作的精密光學玻璃陶瓷模具 可以大幅提升產品良率 SA系列使用於精密設備的大型部件 大幅減輕重量 快速的震動衰減 大量使用於高階數控加工機台與新型光刻機。

光學玻璃鏡頭模具材料



半导体材料

深圳市博金硬质工具有限公司

7A12

微型元件載帶方孔沖模，替代日本進口；最低壽命達一億次，還適應不同的紙帶材質，很受客戶歡迎。

0201編帶沖孔模具



广州汉源新材料股份有限公司

11D57

自主创新技术，打破国外垄断，达到国际先进水平，实现了该关键材料的国产替代，可应用于5G基站、电动汽车、航空航天等核心电子及半导体器件封装焊接。

预成形焊料



北京有色金属与稀土应用研究所有限公司

12C62

微电子封装用钎焊材料主要用于高可靠性、大功率电子器件电路气密封装和芯片焊接。具有高导热性、优良的耐腐蚀性、良好的浸润性和流动性等特点。

微电子封装用钎焊材料



其他半导体材料

夸泰克（广州）新材料有限公司

11D807

旋涂玻璃液/旋涂介电层材料

SOD (Spin-On Dielectric)是利用旋涂的方法进行介质层制作的勺技术。一般是将液态绝缘材料涂在晶圆上，然后通过旋转晶圆来形成一个均匀的薄膜。旋转过程中，多余的勺材料会被甩出。随后，该薄膜经过烘烤处理以固化并最终形成绝缘介质层。拥有绝佳的填洞能力及局部平坦化效果。SOD/SOG的流动性特点使其能够轻松渗透到细微的空隙中，能在空隙中形成极薄的绝缘层，为芯片提供完美的覆盖。



Profactor - (1). 纳米压印模具脱模剂) - BGL-GZ-83. (2). 纳米压印材料的增粘剂 - HMNP-12

利满洋行

6C112

(1). 纳米压印模具脱模剂) - BGL-GZ-83: 2分钟(旋涂) Vs 3小时(蒸镀): BGL-GZ-83只需一部旋涂机，与传统脱模剂不同，要蒸镀过程几小时及需要复杂的测试设置 (2). 纳米压印材料的增粘剂 - HMNP-12 纳米压印有不同种类工作模具材料，如Ormocers 及 Perfluorinated Polyether (PFPE) (聚四氟乙烯)。它们需要增粘剂来与Silicone(硅胶), Quartz(石英) 或Glass(玻璃) 背板粘合。

BGL-GZ-83

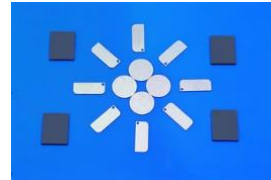


长沙升华微电子材料有限公司

12C707

钼铜材料

钼铜是钼和铜的复合材料，其性能与钨铜相似，同样具有可调的热膨胀系数和热导率。但钼铜的密度比钨铜小很多。产品特色：未加Fe、Co等烧结活化元素，得以保持高的导热性能；优异的气密性；较小的密度，更适合于飞行电子设备；钼含量不超过75%时，可提供轧制板材，便于冲制零件；提供半成品或表面镀Ni/Au的成品；售前/售中/售后全过程技术服务。

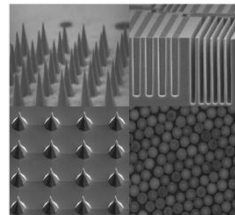


江苏优众微纳半导体科技有限公司

4D175

定制化产品

我司可根据客户需求提供定制化的微纳加工服务，包括特殊微结构定制，深硅刻蚀，紫外纳米压印，精密镀膜，模板表面处理等。



半导体配套产品

友川控制技术（东莞）有限公司

10C56

精密微调滑台/自动滑台

直线滚珠加丝杆结构，通过复杂的高精度加工和组装，实现微米级定位精度的同时，体积非常小巧。还可以根据客户的个性化要求自由搭配组合。六维XYZ轴直动3轴与 $\theta_x\theta_y\theta_z$ 轴移轴3轴上加入自动滑台的组合。可全方向控制，结构对应单芯光纤至光纤排列或光波导及各种光学元件等所有装置的自动耦合用途。除了耦合用途以外，还可以实现6维高精度自动调整和自动对位功能，解决客户问题，提高生产效率。

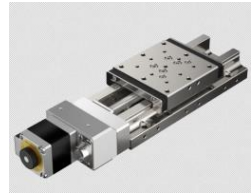


煜汉精机（昆山）有限公司

10B25

电动位移台

电动高精度位移台，轴向包含X/Y/Z/R/ θ ，广泛应用于有空间要求且高精度工位，单向重复定位精度 $\leq \pm 0.5\mu\text{m}$ ；可提供单轴及多轴组合方案。



山洋电气贸易（深圳）有限公司

10A33

新系列伺服系统“SANMOTION G”

高性能、小型化、轻量化、节能的伺服系统“SANMOTION G”系列。适用于半导体制造设备、医疗器械机器人、工作机械、食品机械等。



ISMC

10D37

Diamond Plus 系列
插针式伺服驱动器

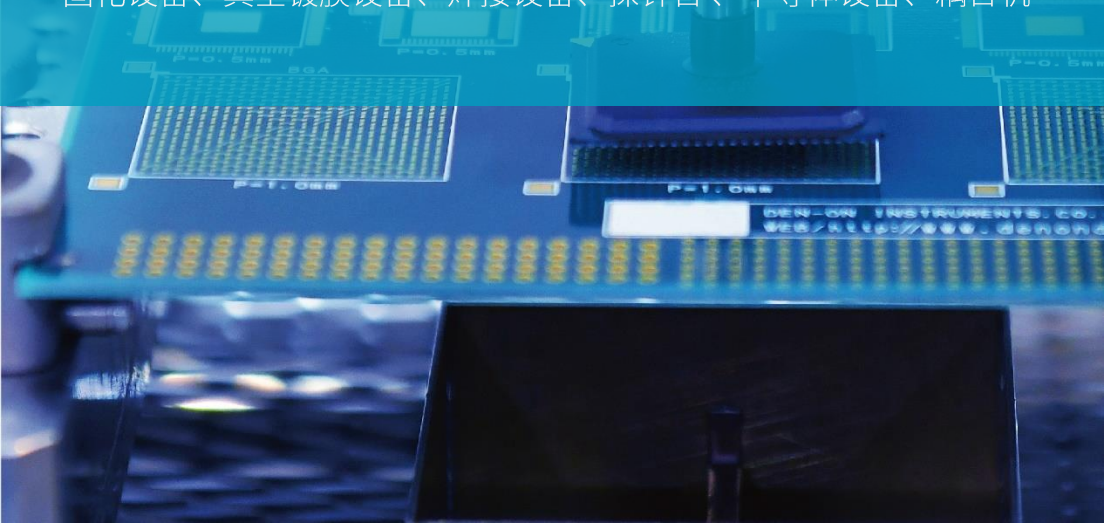
Diamond Plus 系列插针式驱动器是一款小功率、高性能、紧凑型低压直流伺服驱动器，支持12V~60V 直流供电，最大支持 72V 直流供电，功率覆盖 0~750W 应用场景。采用插针式接口设计，便于客户做二次开发。支持标准的EtherCAT/CANopen/Modbus 通讯，配有智能化的终极调试工具，具有全中文界面，参数一键导入，图像化调试等强大功能。支持多种电机类型（永磁同步伺服电机/直流无刷电机/直线电机/力矩电机/音圈电机/步进电机）以及丰富的反馈类型增量式/绝对值/霍尔。





重点展示半导体设备

展示范围：光刻技术/光刻机、键合机、固晶机、试验机、贴片机、减薄机/贴装装备、抛光机、研磨机、清洗机、划片机、光谱仪、蚀刻机/等离子去胶机、切割设备、钻孔设备、显示设备、检测设备、轮廓仪、测量仪、固化设备、真空镀膜设备、焊接设备、探针台、半导体设备、耦合机



光刻技术/光刻机

矽万（上海）半导体科技有限公司

2D068、2D069

大幅面激光直写光刻机

PicoMaster XF ATE-800 是一款具有超高精度的多功能紫外激光直写设备，它具有每毫米超过1200条线的输出能力，特别适合用户在光敏层上自由地创造微结构。



江苏雷博微电子设备有限公司

10D22

SS6-CA全自动光刻机

最大曝光面积：160mm*160mm，曝光分辨率：1 μ m（胶厚 \leq 1 μ m的正胶），对准精度： \pm 1 μ m（标准晶圆抛光片），光源强度：35mW/cm²，曝光波长：LED光源（进口灯珠，寿命约2万小时），曝光方式：定时（倒计时方式），掩模样片相对运动范围：X：优于 \pm 5mm；Y：优于 \pm 5mm； θ ：优于 \pm 6°，掩模尺寸：7英寸，样片规格：6英寸（晶圆片），数字设定对准间隙和曝光间隙，掩模样片分离间隙：连续可调，对准方式：自动对准，可根据客户需求，增加对准标记的类型，累计不超过4组。



托托科技（苏州）有限公司

2E006、2E007

无掩模板紫外光刻机

无掩模光刻设备基于空间光调制器的技术，实现了高速、高精度、高灵活性的紫外光刻。光刻机的分辨率和套刻精度决定了所制造的集成电路的集成度，这是光刻机品质的关键指标。

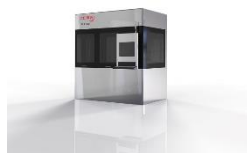


青岛天仁微纳科技有限责任公司

2A103

研发型多功能纳米压印光刻设备

GL4 R&D是一种专门为大学、科研院所和企业产品研发所设计，功能强大的多功能研发型纳米压印光刻设备。通过简单的夹具更换，可以实现旋涂压印胶高精度纳米结构压印和点胶大矢高结构自动找平压印模式之间的快速切换。可实现直径100mm以下基底面积上高精度（优于10nm^{*}）、高深宽比（优于10比1^{*}）以及微透镜阵列等微纳结构压印，适合用作紫外纳米压印光刻工艺开发，器件原型快速验证，纳米压印材料测试等研发。



光刻技术/光刻机

DYMEK Company Ltd.

3A21

EVG610纳米压印光刻系统

该设备支持多种标准光刻工艺，例如真空，软，硬和接近曝光模式，并可选择背面对准。此外，该系统还为多功能配置提供了附加功能，包括键对准和纳米压印光刻（NIL）。EVG610提供快速的处理和重新安装工具，以改变用户需求，光刻和NIL之间的转换时间仅为几分钟。其先进的多用户概念可以适应从初学者到专家级别的所有需求，因此使其成为大学和研发应用机构的理想选择。



Stella International Corporation Limited 6A22

DWL多功能专业型灰度光刻机

●DWL系列灰度光刻解决方案 ●高分辨率的激光直写光刻机，拥有多种选配功能；具有快速灵活的高分辨率达到灰度光刻的专业表现，能在厚光阻中创建复杂的2.5D微结构。



北京优利赛尔科技有限公司

3A40-5

紫外/深紫外光刻机
(桌面手动式)

Phable R 作为一款桌面式手动光刻机，可以满足大多数科研试产需求；手动套刻对准精度可达1~2um；曝光时间< 2min；基片尺寸最大可选6"向下兼容；其可靠的手动操作性能深受科研人员青睐。



维易尔半导体科技

10D36

UTW-2000A涂胶显影设备

UTW-2000A涂胶显影设备是一种结构紧凑，产能较高的半导体生产前道设备是半导体器件、集成电路制造的专用设备之一。其作用是通过控制精确的高速旋转系统将光刻胶均匀的涂敷在基片表面，并通过加热板加热使光刻胶固化，以完成基片自动涂胶的功能，再经过光刻机曝光后通过本机的自动显影功能去除感光胶，从而制造出集成电路的基本图形。该台UTW-2000A涂胶显影设备具备全自动的涂胶、显影、烘干及冷却等各项功能。



键合机

三河建华高科有限责任公司

4A100

晶圆键合机

该设备主要用于主要适用于6”、8”基片的全自动对准、晶圆级临时键合工艺。采用全自动机械手上料，工艺过程连续处理，自动运行。本产品操作方便、稳定性高、重复性好，并具有较高的性价比，可广泛应用于科研和生产。



苏州芯睿科技有限公司

10C22

半自动永久键合机

SPB-08是一款半自动、适合小批量生产的键合系统，支持例如阳极键合、热压键合、胶黏键合、金属扩散键合等常见的晶圆键合工艺。拥有快速加热和冷却的卡盘和独立的顶部/底部加热器、及大压力键合系统。



北京华奥复兴科技有限公司

4D088

多功能键合机

多功能键合机是一款用于芯片和基板之间电气互联和芯片间的信息互通的手动键合设备，该设备基于超声键合原理，通过精密的机械结构和高度集成的硬件软件控制，实现引线与基板焊盘的紧密连接，设备具有球焊和楔焊两种功能，可用于金丝、铂金丝、铜丝、银丝、铝丝、金带等多种类型引线的键合，广泛适用于半导体器件的实验室研发、产品原型试产、产品评估、产品返修等。



宁波尚进自动化科技有限公司

10D35

BRT6000Plus全自动球焊键合机

BRT6000Plus全自动球焊键合机是一款平面焊线机型，可为大规模集成电路市场提供引线键合解决方案，设备适用于分立器件、IC、LED、微波组件、激光器和光通讯器件等。芯片体积变小，键合密度越来越高，这就对焊线精度和焊线速度提出了更高的要求，BRT6000Plus键合精度为 $\pm 2\mu\text{m}@3\sigma$ ，键合速度也越来越快，每线速度达到了45ms。



固晶机

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

10A25

多芯片贴装固晶机

一、主要应用场景：1、高精度，多芯片，复杂工艺 2、内存，工业激光器，光通讯，激光雷达，CIS，MEMS，IGBT 二、产品优势：1、高精度：位置 $\pm 5\mu\text{m}$ ；角度 $\pm 0.1^\circ$ 2、多芯片：全自动更换晶圆，顶针，吸嘴 3、高柔性：模块化，支持多种吸取固晶方式；①来料吸取方式：晶圆，华夫盒，凝胶盒，送料机；②固晶方式：画胶，蘸胶，蘸助焊剂，固晶，共晶，倒装 三、设备尺寸和重量：L1160 * W1225 * H1750；净重 1300Kg。



苏州博众半导体有限公司

10B59

星威系列EH9722-多功能高精度共晶机

星威系列EH9722多功能全自动高精度固晶机，贴片精度 $\pm 3\mu\text{m}@3\sigma$ ，兼具UV&点胶&蘸胶固晶贴片、共晶贴片、Flip Chip功能，可应用于光通信、数据中心等行业，满足COC、COB、COS等领域的多芯片贴装需求。



东莞市耀野自动化有限公司

10C26

高精度固晶机（3微米）

固晶精度3微米(3Sigma)，兼容点胶和共晶工艺，兼容晶圆环和料盒，可以同时安装6个晶圆。



微见智能封装技术（深圳）有限公司

10C35

1.5 μm 高速高精度固晶机MV-15T

微见智能MV-15T高速高精度固晶机三工位协同工作，是专为COB及BOX封装量身定制的胶工艺应用高效率专用设备，在满足高精度，高效率的同时，MV-15T同时兼具灵活性。支持多芯片贴装，点胶/蘸胶系统，物料转运系统，贴装系统均支持多个吸嘴/胶头的自动更换，是芯片封装过程中不可或缺的工艺设备。



半导体设备

固晶机

广州诺顶智能科技有限公司

10D23

PNP6600EVO多功能固晶机

PNP6600EVO多功能固晶机:可通过不同的模组搭配,实现客户不同工艺的固晶类型,为半导体领域提供国产多功能解决方案。可兼容点胶、蘸胶、倒装、加热、UV等功能,XY贴装精度达到 $\pm 7\mu\text{m}@3\sigma$ 旋转角度 $\pm 0.1^\circ 3\sigma$ 。



半导体设备

中科同帜半导体(江苏)有限公司

2B009、2B010

真空共晶炉

VH系列高真空封焊炉是一款专业的用于Getter热激活的高真空封焊炉,采用上下红外加热方式,配有氮气、甲酸可控的工艺气氛环境,实现高真空或者气氛环境下工作。可同时完成吸气剂的高温激活和芯片的低温焊接,设备控温精度高工艺稳定,实现器件焊接后较低的空洞率、很高的气密性,设备外壳采用水冷方式,保证设备长期使用的可靠性。HV3高真空共晶炉最高焊接温度可达 500°C ,极限真空 $\leq 10^{-4}\text{Pa}$,采用上下红外加热方式,配有氮气、甲酸可控的工艺气氛环境,温度均匀性好,性能稳定。



上海世禹精密设备股份有限公司

10C29

高精度低载荷固晶机

本高精度固晶机为满足高精度和高效率固晶需求而设计,定位精度达 $\pm 0.5[\mu\text{m}] (3\sigma)$,通过贴装头周围的整体铸造结构提高刚性。设备提供 $0.049[\text{N}]\sim 1000[\text{N}]$ 的广泛粘接范围,无需更换头部。适用于最大 $200\times 200\text{mm}$ 面板(或8英寸晶圆)及 $0.3\times 0.3\text{mm}\sim 30\times 30\text{mm}$ 的芯片,兼容正装和倒装等多种应用。凭借卓越性能和灵活性,本固晶机在集成电路和光电子器件等半导体和微电子产品生产中发挥重要作用。欲了解更多详情或获取报价,请联系上海世禹精密设备股份有限公司,我们将竭诚为您提供服务和解决方案。

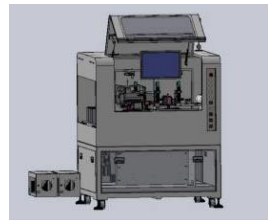


深圳市大成自动化设备有限公司

10D29

高精度固晶机

三视觉TO固晶机是一款用于光通信封装行业的专用设备,可把阵列方式排列附设于蓝膜上的管芯直接固定到管座指定位置上。主要机构为取晶视觉校正移动式直线马达工作台,固晶视觉校正移动式旋转直线马达工作台,晶环上下料机构,管座模条上下料机构,点胶机构,取晶升降摆臂及顶针机构。主要功能,全自动上下料,能够自动吸取放置在取晶工作台上的管芯,通过固晶旋转伺服马达,调整角度使管芯准确固定在管座上。该设备采用二次视觉校正,排布精准,速度响应快,运行可靠,自动化程度高,可一人多机操作,能够节省人工工时及人工成本。



试验机 / 芯片测试机

广东莱伯通试验设备有限公司

10A28

综合环境试验机

我们一直关注可靠性试验技术的最新发展,非常重视提高可靠性试验设备技术。“环境仿真”的要求也使客户认识到由一家供应商提供振动台和试验箱以实现完整综合试验的重要性,我们可以依据客户不同的试验需求,提供范围广阔的综合环境试验系统,如三综合、四综合试验设备方案、多轴振动试验系统和最新试验技术。



半导体设备

成都中冷低温科技有限公司

10A71

高加速寿命试验箱

HAST高加速寿命试验箱主要用于评估在湿度环境下产品或材料的可靠性,这是通过在高度受控的压力容器内设定和创建温度、湿度、压力的各种条件来完成的,这些条件加速了水分穿透外部保护性塑料包装并将这些应力条件施加到材料本体或者产品内部。HAST测试已成为某些行业的标准,特别是在PCB、半导体,太阳能、显示面板等产品中,作为标准高温高湿测试的快速有效替代方案。



河北圣昊光电科技有限公司

10D51

LD芯片测试机

LD芯片测试机用于对LD芯片的电气和光学特性进行检测、判定与分选。主要包含DFB芯片低温/高速双温测试机、DFB芯片高频特性测试机、EML芯片测试机、COC特性测试机和大功率芯片测试机。该系列产品具有测试速度快、温控精度高,测试数据的再现性和相关性稳定可靠、数据准确等优点。发散角测试(选配):快轴发散角 测试范围:±60° 慢轴发散角 测试范围:±60° 分辨率:0.072°。电机驱动测试模式:(1)普通LD(DFB)模式(2)LD+EA模式(3)LD+SOA模式(4)LD+EA。



飞空微组贸易(上海)有限公司

10C620、10C621

ficonTEC 芯片级/晶圆级光电混合测试设备

全自动测试系统,用于针对激光芯片,VCSEL,激光半导体巴条以及chip-on-submount(CoS)的全套LIV测试以及光谱和近/远场光束特征测试。系统还可用于实现各种其他复杂任务,包括单芯片测试,晶圆级测试,自动光学检测等等。高端型号可配备可选晶圆平台以实现晶圆处理任务,而在线平台则为生产线提供在线测试功能。



贴片机

芬泰电子（上海）有限公司

10C622、10C623

亚微米贴片机

全新的 FINEPLACER® lambda 2 以其广受赞誉的第一代 lambda 为基础，将在精密芯片键合和先进的芯片封装方面为光电组件和更多产品设置新的标准。完全修订的贴片平台可以很容易地针对工艺研发或原型设计的广泛应用进行配置。大量的过程模块选项和现场改造能力保证了最大的技术灵活性，以保护您的投资面临不断变化的挑战。



珠海市硅酷科技有限公司

10C69

HS-DB2000 高速贴片机

灵活配置多种芯片/物料上料方式，适用于多芯片贴装、银胶贴片、叠层封装；模块化设计，具备高度升级扩展能力；高精度：±5um@3σ，高速度：CPH800-1000，精准力控：20-200g±2g/200-1000g±20g；支持全自动更换吸嘴/顶针模组/蘸胶头，提高生产效率。



半导体设备

深圳市锐博自动化设备有限公司

10C76

自动点胶贴片机 DB-560P

DB-560P是COB/COC制程中将基底(PCB或其他待加工材料)与芯片，经过点胶工艺键合的生产设备。



北京三吉世纪科技有限公司

10D61

MRSI高精度贴片机

全自动、高速、高精度、灵活多功能的贴片系统。为激光器、探测器、调制器、AOC、WDM/EML TO-Can、光收发器、LiDAR、VR/AR、传感器和光学成像等产品的研发、小到中等批量生产，直至大批量生产提供“一站式”解决方案。为所有级别的封装提供最有效的系统和组装解决方案，其中包括晶片芯片(CoW)、载体上芯片(CoC)、PCB、TO、和管壳封装。



贴片机

中国电子科技集团公司第二研究所

10D11

全自动共晶贴片机

本设备专用于TO（晶体管外形）型激光器的全自动共晶贴片。从TO管控的上料开始，经过晶圆上料、精密平台校准、SUB（热沉）共晶贴片、LD（激光二极管）芯片共晶贴片，到成品下料，以流水线方式完成TO器件的热沉与LD芯片贴片生产工艺。此设备具有高速、高精度的特点，实现了复杂时序、严密逻辑的工艺过程。设备采用凸轮驱动、连杆联动、精密夹具等结构，配合多轴运动控制、视觉定位等技术，具有批量生产能力。



MRSI-HVM1高速，
灵活的1微米贴片机

半导体设备

迈锐斯自动化（深圳）有限公司

10B79

MRSI-HVM1设备以其领先的速度，吸嘴间的“零时间”切换和小于1微米贴片精度被公认为业界领先的一流贴片机。其双机头、双共晶焊接台、“零时间”吸嘴切换系统的配置，超快速共晶焊接温度的升降以及多层次多功能并行工艺自动化处理，实现了MRSI-HVM1产品卓越的性能。MRSI-HVM1专为特定应用而设计，包括使用共晶和/或蘸胶工艺的CoC封装、CoS封装和CoB封装。工艺流程可选择包括共晶焊接、环氧蘸胶粘结、UV环氧点胶和原位UV固化。



全自动智能共晶贴片机
AOI-TP300

湖南奥创普科技有限公司

2B030

AOI-TP300全自动智能共晶贴片机是一款兼容多种上下料方式、单管四面检测、全自动共晶贴片、COC四面检测的多功能机型。AOI-TP300以大理石为主体结构，并具备高精度的视觉定位机构及高灵敏度的压力控制机构，可实现高精度、高稳定性的贴片效果，贴片良率高达99.8%。



深圳市微组半导体科技有限公司

2A065

半导体IGBT贴片机

主要是针对功率器件产品研发的一款贴片机，兼容SMT型送料Feeder、Tray托盘、Wafer晶圆盘之自动上料系统。采用高强度钢铁机架&主轴(X/Y)精密铸造件&大理石平台保障整机精度及结构刚性。X/Y轴采用直线电机及高精度光栅尺保证设备运行精度。4/6高精度直线驱动贴装头，音圈电机实现精准力控，具备激光测高功能保证贴装精度及稳定性。搭模块化设计，根据不同生产工艺可定制化。高精度搜寻芯片平台，芯片自动角度校正系统。具备真空漏晶检测和重新拾取功能。适用于12吋及12吋以下wafer，含自动扩膜系统。



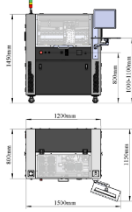
贴片机

长沙芯尖半导体有限公司

4D128、4D129

MP-01E 共晶贴片机

长沙芯尖半导体有限公司，成立于2023年，位于湖南省长沙市，是一家从事专用设备制造业为主的企业。应用于激光器芯片共晶封装的高精度设备。



苏州博众半导体有限公司

10C59

星威系列EF9621-全自动高精度共晶贴片机

星威系列EF9621共晶贴片机主要应用COC及COS工艺场景，可支持4Wafer同时上料，解决客户多工艺多芯片一机生产，提高生产效率。



深圳市佳力兴业电子科技有限公司

10C25

最适合LED电路板生产的NXTR S贴片机

针对LED电路板的生产，Fuji提供了相关的解决方案：1.单通道传板方式，提高生产效率；2.采用旋转式贴装头，可以使吸取位置最小化，同一种元件最小化；3.一个模块的CPH12000点，以最小的空间实现最高的性能，面积生产率 70,999CPH/m² 4.高品质贴装，以低冲击喷嘴实现最佳载荷贴装，全点实时检查元件（IPS功能）5.高速单供料器，支持高速贴装，使用W08t供料器可以提高送料速度。

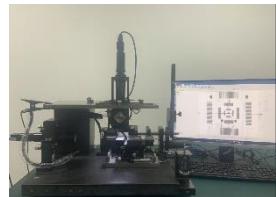


北京日月威科技有限公司

10D733

亚微米级贴片机

1.高精度对准：±0.5μm的对准精度，设备能够在极小的尺度上进行精确的定位，这对于芯片贴装和微组装机工艺至关重要。2.工艺应用：设备支持包括倒装焊、超声波金球焊、激光巴条、金锡共晶焊、点胶键合、微组装机等多种封装技术。3.模块化设计：模块化设计允许用户根据具体需求选择不同的配置，增加了设备的灵活性和适应性。4.适用性广泛：适用于倒装芯片、正装芯片、Micro LED等不同的应用领域。5.目标客户：FLO F3旨主要针对小批量生产以及原型制造、科研开发和大学教研等领域的需求而设计。



半导体设备

减薄机/贴装装备

上海世禹精密设备股份有限公司

10C29

全自动晶圆背面减薄机

全自动8寸晶圆背面减薄设备由上海世禹制造，关键功能包括粗磨和精磨。这些设备专为半导体制造设计，用于对8寸直径晶圆进行背面加工。设备配备精密加工部件，能够在背面减薄过程中控制总体厚度变化（TTV）在3微米以内。特别是对于光通芯片，设备能够实现表面粗糙度控制在3纳米以内，以确保光学表面的高精度和优质制造。同时，设备设计考虑了操作安全和环境保护，满足半导体工业对高精度加工的严格要求。



AG6800 4-8英寸全自动减薄设备

半导体设备

江苏京创先进电子科技有限公司

10B52

4-8英寸全自动减薄设备 In-Feed磨削方式。精密进口滚珠丝杆、直线导轨，Z向精密控制，高精度机台长时间保持。双主轴，三工作盘，加工效率高。全自动上下料、传输定位、清洗干燥，实现全自动运行模式，大大降低OP工作量。稳定的超薄减薄加工。兼容性好，与市面上的其他类型设备，关键耗材兼容性强。便捷的操作与人机交互界面。



米艾德精密技术（苏州）有限公司

10C73

高精度微模块贴装固化线

可实现功能：自动画银胶 自动画UV胶 黑胶补强 UV胶点光源固化UV胶面光源固化 行业应用：适用于各种微模块-无源器件、传感器模块、激光器模块、VR/AR等自动组装；对于光通讯行业，兼容100G/200G/400G产品半成品、隔离器、LENS、潜望镜、Z-block等玻璃件组装。关键参数：最高贴装精度 $\pm 6\mu\text{m}$ 最高贴装角度 $\pm 0.1^\circ$ 贴装压力30-2000gf可调 单一件3S/Pcs 良率 $>99\%$ 。



北京创世杰科技发展有限公司

10B36

全自动高精度多功能贴装系统

T-8000-G贴装系统是一款全自动、多功能、高精度、高效率的贴装设备。该设备主体采用大理石框架结构，大尺寸贴装区域700 X 500 mm 支持自定义区块划分及夹具配置；支持2" -12" 晶元拾取；X和Y轴使用线性马达驱动设计，采用精度为 $0.1\mu\text{m}$ 的线性光栅编码器，使得它在总体复合精度高达 $2.5\mu\text{m}@3\sigma$ 同时拥有了较快响应速度；压力范围从15g到800g(可选15g到5Kg)。该设备拥有众多可选配置。



抛光机

浙江森永光电设备有限公司

5C68

高精度双面研磨机/抛光机

①②高精度双面研磨/抛光机：4马达驱动，上下定盘和内外齿圈均可以单独控制，工艺范围设置范围更广。采用改进版机床底座，零部件精度等级均已提高，按机床标准制造设备，国内精度最高的研磨抛光设备。
③高精度单面抛光机：上下盘水冷结构优化，下盘端跳 ≤ 0.02 ，精度比国内其它厂家均高。可承受大压力工况。



坂口电子机械（上海）有限公司

5E76

平面研磨机 抛光机

致力于薄物高精度研磨抛光设备的研究与应用，广泛应用于光学玻璃、陶瓷基片、液晶显示、LED蓝宝石衬底、电子材料、半导体材料（硅片，锗片、碳化硅、砷化镓、氮化镓等）以及金属和非金属易碎的精密零件的研磨和抛光。



半导体设备

四川至臻精密光学有限公司

5C60

机器人抛光机

基于时间维度调制的面形加工技术 实现位置浮动抛光力恒定的加工 集三种抛光头自由互换 可加工精度：PV<100nm, RMS<12nm 可加工材料：常规光学玻璃（石英、微晶、K9等）、红外光学材料（硅、锗、等）、金属（铝、不锈钢、钛合金等）、晶体材料（YAG、单晶碳化硅等）、碳化硅、其他 可加工形状：常规光学元件（平面、球面、棱镜）、复杂光学元件（对称非球面、离轴非球面、柱面）、特殊光学元件（超薄元件、板条元件、半球元件、保形元件、相位板、自由曲面、其他形状元件）。



苏州赫瑞特电子专用设备科技有限公司

5C53

双面研磨/抛光机 单面抛光机

本设备主要用于半导体，蓝宝石，光学玻璃，石英，陶瓷，金属等硬性材料的高精度双面研磨和抛光加工。



研磨机

苏州博宏源设备股份有限公司

5C21

24BF 精密双面平面研磨/抛光机

主要用于硅片、蓝宝石、半导体材料、蓝玻璃、陶瓷片、晶体及其他硬脆材料的高精度双面研磨 1、整机采用PLC+PT+电气比例阀+加压气缸+精密拉力传感器实现高精度压力闭环控制，压力控制精确，压力控制精度可达±2Kg 2、上盘系统采用轴承卸荷双安全挂钩装置，并具有气源欠压保护及断气保持装置，安全性高 3、四电机独立同步拖动，主机精度高传动平稳上采用日本高性能的PLC及人机界面；自编程实现低速平稳、启停同步运转控制，速度精度±0.5rpm； 4、上盘调心装置，旋转与调心动作分离，最大保证了上下盘动态条件。



东莞市长光智能装备有限公司

9C204、9C205

研磨机

CGZN-380XMTJ是一款可任意设定转速的平面带修面研磨抛光机，可加工陶瓷 石英 玻璃 金属 塑胶等材料。独立的自转和公转复合陶瓷圈运动，保证研磨品质的均匀性和一致性，公自转可无级调速。显示屏智能编程控制转速5---110之间，可满足3个阶段不同的研磨转速要求，3个阶段不同的研磨时间设置。并可根据加工要求任意设置研磨时间，研磨盘平面在公转速度为110rpm时的跳动在0.005mm之间，自动记录研磨次数，可指导操作者根据研磨纸使用次数调整研磨时间。



半导体设备

深圳西可实业有限公司

5C15

SM724-5A 双面研磨机

本机型为四电机拖动的双面研磨设备，可装载 5个 28B 的游星轮 主要用于碳化硅、蓝宝石、砷化镓、陶瓷片、晶体、半导体等硬脆材料平行平面的高精度双面研磨加工，也可用于手机面板玻璃、车载玻璃及各种触摸屏面板的双面研磨加工；尤其对于大直径的加工具有明显的优势。



沈阳和研科技股份有限公司

10C65

全自动晶圆研磨机-HG5260

HG5260是一款二轴三研磨台盘、晶圆自动传送和上下料的全自动研磨机，装备高刚性气浮主轴，四轴洁净室专用机械手，大量程高分辨率测厚仪等，机台兼容8/12inch两种主流晶圆的背面研磨，实现无需硬件更换的自动尺寸切换功能。



清洗机

江苏晶工半导体设备有限公司

2D058

全自动单片晶圆清洗机QX-6800

全自动晶圆单片清洗机QX-6800为半导体晶圆清洗的专用设备,通过化学药液清洗可有效去除衬底片/外延片表面及背面的尘粒、剥离晶圆表面的金属离子以及其他有机物。



半导体设备

中科光智（重庆）科技有限公司

10A39

立柜式微波等离子清洗机

多功能立柜式等离子系统，适合于批量生产领域。真空微波等离子清洗机主要用于材料表面微观净化、活化、改性、去氧化、刻蚀、去胶、沉积等处理，具有无损伤清洗、完美兼顾物理和化学清洗方式、超洁净清洗效果、优秀的去氧化清洗能力、工艺温度低等特点。



宁波润华全芯微电子有限公司

10D76

湿法清洗机

机台可实现多尺寸兼容，可应用于先进封装，MEMS,功率器件、射频集成电路、面板显示、光通讯、科研等。



深圳洁盟技术股份有限公司

7B32

大型等离子清洗机

真空式等离子清洗机功能特点： 1、PLC+人机界面控制，操作简单 2、支持权限分级+独立密码锁 3、可切换手动模式或自动模式 4、具有多种互锁功能，保证设备使用安全 5、真空舱体分层设计，根据处理产品大小灵活使用 6、高真空度舱体设计及制造工艺，拥有优良的密封性 7、底部安装福马轮脚轮，助停方便牢固，高度可调节，可防尘 8、超温、过载、短路等异常提示和报警功能 9、独特的放电技术，等离子形成均匀稳定，保处理效果更出众 10、超低温处理，不损伤基材，兼容各种材料。



划片机

北京三吉世纪科技有限公司

10D61

MRSI高精度贴片机

全自动、高速、高精度、灵活多功能的贴片系统。为激光器、探测器、调制器、AOC、WDM/EML TO-Can、光收发器、LiDAR、VR/AR、传感器和光学成像等产品的研发、小到中等批量生产，直至大批量生产提供“一站式”解决方案。为所有级别的封装提供最有效的系统和组装解决方案，其中包括晶片芯片(CoW)、载体上芯片(CoC)、PCB, TO, 和管壳封装。



江苏京创先进电子科技有限公司

10B52

AR9000 12英寸双刀精密自动划片机

由京创先进自主研发的全新双轴全自动减薄机，主要用于8-12寸半导体晶圆的全自动减薄加工。可用于硅，氮化硅，磷化铟，砷化镓，薄膜铌酸锂，碳化硅，石英及玻璃等材料的减薄。



沈阳和研科技股份有限公司

10C65

精密划片机-DS9260

DS9260精密划片机是一款12英寸双轴全自动机型。该机型实现了晶圆从装片、对准、切割、清洗到卸片的自动化操作，大幅度提高了生产效率。广泛应用于IC、光学光电、通讯、LED封装、QFN封装、DFN封装、BGA封装等领域。



郑州琦升精密制造有限公司

2A050

划片机

主要用于半导体封装行业的专用切割设备，针对QFN、BGA、PCB板等设计的具备大行程，自动识别的专用设备，配备大功率直流主轴，可切割难加工产品。



光谱仪

忆玺智能科技（杭州）有限公司

4A007、4A008

UV-VIS TE制冷光谱仪

YSM-8104系列高性能TE制冷型光谱仪，采用了滨松公司先进的背照薄片式制冷型面阵CCD，提供1024像素和2048像素两个版本，具有非常好的科研级灵敏度。其优化的低噪声电路系统，采用了18位A/D转换器，再配合优秀的CT光学机械结构，大大提升了光谱仪的信噪比、灵敏度以及热稳定性，非常适合拉曼和荧光等弱光谱信号的测量。



半导体设备

安徽鹿起科技有限公司

6E16

LUNA系列微型光谱仪

LUNA系列是微型化模块光谱仪产品，共有LUNA-ST、LUNA-HS和LUNA-HR三款型号产品，适用于UV-VIS-NIR波段，其主要区分在于LUNA-ST型号产品定位是标准款光谱仪模块，其主要工作光谱范围是350nm-1000nm。LUNA-HS型号产品主要面向紫外波段探测和高速测量的应用场景，光谱范围可以覆盖200nm-1000nm。LUNA-HR型号产品主要面向高分辨率探测的应用场景。该系列产品使用USB2.0接口进行数据通讯和供电，标配SMA905光纤接口和16Pin I/O口。



光谱时代（北京）科技有限公司

1D76

高分辨率光谱仪

Hyperfine系列光谱仪基于LightMachinery得射流喷射抛光技术制造的标准具设计，其最小光谱分辨率为1pm。特征应用为测试超精细光谱和细微的光谱偏移，是脉冲激光，布里渊散射以及拉曼散射的理想检测仪器。Hyperfine系列光谱仪采用光纤输入，无移动部件。



河南精谱检测设备有限公司

7D20A

傅里叶红外光谱仪

贵在细节美在品质 傅里叶红外光谱仪由河南精谱自主研发、精心打造，主要采用迈克尔逊干涉仪原理，利用计算机采样将干涉图变换为红外光谱图。设备具有分辨能力高、光能量输出大、光谱范围宽、测量时间短等优点，在材料科学、医疗化工、石油、珠宝等领域广泛应用。同时在各大高等院校、科研院所、政府机构等机构相关专业也必不可少。作为专业生产厂家，河南精谱的傅里叶凭借过硬的产品质量、极高的性价比及最专业的售后服务，在行业内赢得了广大客户的支持与认可，且一直保持较高的市场占有率。



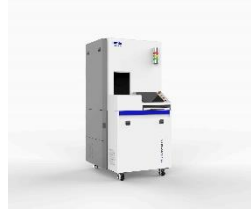
蚀刻机 / 等离子去胶机

北京哲勤科技有限公司

7D05

IoN Wave 10 微波等
离子体去胶机

IoN Wave 10是PVA TePla在微波等离子体处理工艺中的最新产品。该设备尺寸适中、性能先进。IoN Wave 10配置最新的性能出色的组件和软件，对工艺参数进行精确控制。实现最严格的质量控制。IoN Wave 10安装和维护简单。微波等离子技术，提供了极高的光刻胶灰化速度，降低了在静电放电中的风险。应用：光刻胶灰化 去除牺牲层（PI等）去除底膜晶圆和衬底的清洁 刻蚀钝化层（氮化硅等）SU-8灰化 去除聚合物 边缘刻蚀(去除PSG层) 失效分析中的器件/PCB开封。



半导体设备

科毅科技(东莞)有限公司

4B007、4B008

真空微波等离子去胶机

晶圆尺寸：4吋-12吋 微波电源：功率3KW,频率2.45GHz 容积：100L/450×450×450mm 控制系统：PLC 气路配置：标配氧气、氩气两路工艺气体（可定制CF4气体）。



宁波润华全芯微电子有限公司

10D76

去胶剥离机

设备为全自动机台，可自动完成去胶、金属剥离工艺，药液可循环利用，可应用于先进封装、MEMS、功率器件、射频集成电路、面板显示、光通讯、科研等。



Samco

10C108

感应耦合等离子刻蚀机

使用于InP GaAs GaSb等材料的刻蚀，广泛应用于光电器件、MEMS和功率器件等芯片的研发和生产。



切割设备

深圳锦帛方激光科技有限公司

2C036

30W紫外切割设计

紫外激光器最常见的是波长355nm的产品，具有短波长、短脉冲、光束质量优异、高精度、高峰值功率等优点。紫外激光器与绿光、红外相比，具有更小的热效应，随着激光波长的变短，各种材料都具有更高的吸收率，所以紫外激光又被称为“冷光”，其加工材料又被称为“冷加工”。



半导体设备

先进微电子装备（郑州）有限公司

10D706、10D707

6110 半自动单轴6吋
晶圆切割机

ADT 6110是一款高精度，高性能单轴半自动切割机。占地面积小到极致，结合全新设计的操作系统，提供高效、低使用成本的切割体验。标准配置2.2kw高转速主轴，θ轴采用DD马达驱动，并搭载自动校准，自动切割，刀痕检查功能。可选配搭载残片形状识别，指定检查位置一键直达等功能。适用于精密加工晶圆、陶瓷、玻璃、碳化硅等各类半导体材料。



武汉光谷航天三江激光
产业技术研究院有限公司

2A056

激光隐形切割设备

激光隐形切割技术是将特定波长的激光通过光学系统聚焦在材料内部进行扫描加工，在材料中间形成改质层，再通过裂片、底膜拉伸等方法对材料施加外力分割成芯片的切割方法。与传统的机械刀轮切割比较，具有切割效率高、材料无损耗、崩边小、无粉尘等优势。

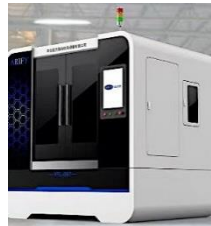


光科朝阳（深圳）光电技术有限公司

2A038

五轴激光加工切割机（精度1微米）

超快激光（飞秒/皮秒）具有极高的峰值能量，可对透明、硬质、脆性、高熔点等几乎任何材料进行多光子吸收加工处理，不会造成材料热熔，且速度快、精度和效率高。超快激光被认为是未来精密的制造工具，是解决精密加工难题的重要手段。



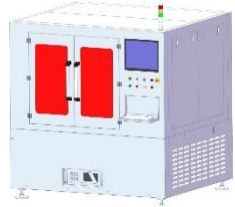
钻孔设备

锐莱特精密光电技术无锡有限公司

2A030

玻璃激光打孔机

RayGlass C1006系列玻璃激光打孔机具有如下特点：1、打孔速度快，精度高，稳定性好，品质高，成品率高；2、可直接加工圆孔、方孔、阶梯孔、异型孔、任意曲线图形等，图形完全由电脑程式化设定；3、玻璃最大尺寸可达900*600mm；4、操作简单、效率高、玻璃无需用水冷却；5、可直接加工多种玻璃、石英等透明脆性材料。



半导体设备

杭州银湖激光科技有限公司

2A060

玻璃激光钻孔设备

该设备采用进口光纤激光器，配备高精度振镜和高稳定性工作平台，适用于多种行业中各类玻璃的钻孔和切割。可根据客户的不同需求提供定制化服务，满足各种玻璃的加工要求。产品优点：加工速度快，可达45mm/s@0.5mm 产品一致性好，成品率99.5% 非接触式加工，光路免维护工业化设计，7*24运行条件下保证加工精度和运行稳定性。



深圳市韵腾激光科技有限公司

2A070

高精密玻璃激光钻孔设备

应用领域：主要应用在盖板玻璃、家电玻璃、安防玻璃、灯饰玻璃、光伏玻璃等。机台特点：1、非接触式加工，对材料损伤小，钻孔精度高。2、高速钻孔，崩边小、效率高。3、CCD拍照定位，精准可控。

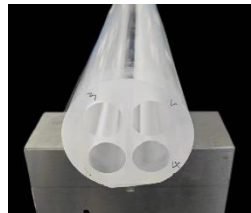


精準機械公司

2C001、2C002

石英玻璃钻孔专用机

精准石英玻璃专用深孔钻床采用重型机身设计和先进数控技术，能够为石英玻璃加工提供高精度、高光洁度解决方案。核心优势包括卓越机械刚性和振动抑制性能，确保工件在高速切削下保持超高加工精度。专用夹具可靠固定各种尺寸形状工件，先进数控系统实现位置和速度高精度控制，确保加工质量稳定性。凭借出色性能，此设备能大幅提高生产效率，保证整个加工过程可靠性和环保性。该机床能满足光纤行业对高精度高光洁度产品需求。



显示设备

武汉国创科光电装备有限公司

2D126

新型显示产线配套装备

产线配套系列装备是为新型显示领域中喷印打印工艺段外的产线开发的系列装备，主要包括AOI、贴合、修复等。AOI产品线主要应用于OLED EL工艺段的particle及膜层缺陷检测。AOI系列与国创科的膜层与像素结构系列设备配合可实现从喷印到检测的整体方案。贴合产品线用于将上下基板通过视觉自动对位后进行贴合。通过精密压力控制系统，保证上下基板贴合质量，无气泡、剥离产生。电流体修复产品线采用直写与电流体技术结合，收敛线宽实现高精度的线路打印。配置高精度运动平台及喷头系统，可实现精密焊盘结构打印修复。



季华实验室

2C115

超高分辨率OLED发光层像素
喷墨打印成套验证装备

200mmX200mm OLED 发光层像素喷墨打印验证装备主要用于对OLED 发光层像素喷印工艺、喷孔控制算法、墨路稳定性等进行验证，指导后续OLED 4.5代线发光层像素喷墨打印装备的设计工作。该OLED发光层像素喷墨打印验证装备能够成为OLED喷印行业重要的试验设备，对工艺、墨水材料、供墨系统、喷印控制算法、喷印环境等喷印的重要因素进行测试，能够大幅提升企业的工艺设计效率，同时也能成为从事相关研究的高校及科研院所的试验测试平台，帮助其开展科研探索。



卫是（上海）电子有限公司

7D15

JV33真空计显示器

JV系列真空计显示器用于显示和控制wisen的真空规管,与wisen真空规管JPC、JPR、JPM系列一起用于总压强的测量与控制。JV系列显示器完美兼容INFICON各型号真空规管。



深圳市同睿数码科技有限公司

2D171、2D172

工业/显示器

产品可选尺寸7-23.8寸，全铝合金材质，机身坚硬，防腐耐磨，纯平面板，全封闭后盖，无风扇散热，IP65级别，防水防尘抗干扰，适用于高低温、粉尘密集等各种恶劣环境，性能稳定，全铝打造导热性能更佳，可24H运行；安装方式支持嵌入式、桌面式、壁挂式、吊臂式等；应用于工业设备、数控机床、医疗设备、自助服务等。



检测设备

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

10A25

全自动芯片四面外观检测设备

一、主要应用场景：光通讯、高功率激光芯片等单芯片外观检测 二、产品特点： 1、设备尺寸：L1800*W1250*H1900 2、检测缺陷类型：脏污、划痕、崩边、异色、解理纹、膜层脱落等 3、瑕疵判定方式：基于深度学习的缺陷检测+传统算法辅助（瑕疵大小、面积、比例等可自由设定）①上表面（P面）最小瑕疵检出：3.6um（选配：2um）②下表面（N面）最小瑕疵检出：5um ③端面（HR/AR面）最小瑕疵检出：0.5um ④选配端面（HR/AR面）：微弱解理纹专项。



CFW380-后段工艺
光学检测设备

珠海诚锋电子科技有限公司

10A23

应用场景：OQC, 切割后检测, 扩膜后检测 专用切割道检测算法： 1. 划片道崩边宽度和深度 2. 切割道扩开后的宽度(die间距) 3. 扩膜后两侧切割道分别的宽度(检测是否划偏)。



珠海诚锋电子科技有限公司

10A23

CFW820-FAB前段缺陷监控设备

一、检测功能：5in1功能（晶面检测、背面检测、边缘检测、翘曲度量测、厚度量测）二、应用场景：ADI/AEI/Post CMP/OQC 三、晶圆尺寸：支持12”/8”/6” wafer、12寸薄片支持：Taiko wafer中心薄至75um、12寸Thin wafer薄至130um 四、设备功能（超高兼容性）：兼容 Taiko/Thin/Standard wafer、支持各种减薄工艺、伯努利fork支持翻转功能（可选）、Throughput and sensitivity对标国外友商-双通道检测、ADC自动缺陷分类-基于深度学习 五、设备特点：大缺陷快速筛选。



恩纳基智能装备（无锡）股份有限公司

10D31

A18智能外观检测装备

A18是恩纳基的AOI智能外观检测设备，主要检测wafer及die检测，在执行芯片外观检测的同时可根据需要选配自动对焦功能、拾取力控制功能、芯片分选功能。设备稳定性高、检测效率高，可支持自动上下料。针对芯片尺寸小于1mm以下，可定制显微镜级镜头并以自动对焦功能保证检测清晰度和精度。检测结果可以结合已有的地图数据文件输出最终的结果地图数据文件。



半导体设备

检测设备

苏州瑞霏光电科技有限公司

3D25

晶圆翘曲应力测量仪

晶圆翘曲应力测量仪Stress Mapper具备晶圆三维翘曲（平整度）、薄膜应力、宏观缺陷成像等检测功能，适用于半导体晶圆生产、半导体制程工艺开发和玻璃及陶瓷晶圆生产，以简单、精确、快速、可重复的测量方式，对各种晶圆的表面进行一次性非接触全口径均匀采样测量，另可附加晶圆加热循环模块。



半导体设备

西安恩科微纳光电科技有限公司

3E30

微纳轮廓检测仪

非接触检测表面微纳及缺陷，台阶高度，划痕深度，钢球粗糙度等。

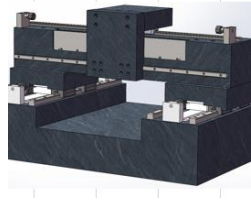


山东善能精密机械有限公司

5C73

龙门式高精度自动光学检测光机

三轴采用直线电机+光栅尺+直线导轨组合传动方式，有效保证定位精度的同时可以减小传动装置运作时对设备测量精度产生的精度，从而获得更准确的测量数据。每组直线导轨自身直线度、相互平行度最高可以达到0.002mm。可广泛应用于高精密加工、检测领域。



品图锐光科技（深圳）有限公司

3D78

晶圆和封测缺陷检测设备

半导体晶圆及封测外观检测机 高精度、高准确度、高效率检测晶圆表面划伤、尘点、崩裂、线路不良等缺陷；亦可检测封装和测试段IC产品的引脚、封装表面、植球的外观缺陷等。



检测设备

天津华慧芯科技集团有限公司

6C86

AOI设备

半导体AOI设备 生产来料规格: 8寸Cassette/12寸标准FOUP、划片后晶圆检测缺陷尺寸: 晶圆检测最小缺陷尺寸:1.5 μ m 成品器件/PCB基板最小缺陷尺寸:15 μ m 产能效率: 晶圆: 60分钟/片 芯粒外观AOI设备 典型被检芯片类型: DFB、EML 最小产品尺寸: 100*100*70MM 产能UPH: 1200 根据检测产品和检测需求定义。



半导体设备

杭州明察智识科技有限公司

10A702

光学玻璃AOI仪

光学石英/玻璃、玻璃晶圆 (Glass Wafer) 等表面瑕疵检测, 如灰尘、纤维、毛丝、气泡、划痕等。最大支持8英寸样品, 最高分辨率1微米。



江苏维普光电科技有限公司

6E24、6E25

半导体晶圆AOI自动光学检测设备

国产半导体晶圆AOI自动光学检测设备, 可满足苛刻的半导体晶圆制造过程检验, 产品应用于泛半导体、CMOS图像传感器、VCSEL、Micro OLED、MEMS和RF等领域, 服务于行业领先的IDM、OSAT和代工厂。



深圳市壹倍科技有限公司

2C126、2C127

Micro LED AOI量检测设备

Micro LED AOI量检测设备 产品型号: α -INSPEC M1070A 产品特点: 大视野超高速检测、强大数据的分析能力、亚微米级分辨率 产品介绍: 该产品配置高解析力的AOI系统, 结合高速图像处理算法, 能够从外观缺陷的多种角度对Micro LED芯片进行快速诊断与分析。做到无接触、非破坏性和超快速的缺陷检测, 可检测晶圆表面划伤、残胶、外延缺陷、位置偏移、偏转、缺失等, 从而大幅提高生产效率和良率, 降低生产成本, 加速产业发展。



轮廓仪

布鲁克（北京）科技有限公司

3A42

三维光学轮廓仪 ContourX-500

ContourX-500 光学轮廓仪是全球功能最全面的自动化台式系统，可快速完成非接触式三维表面计量。ContourX-500 具有卓越的 Z 轴分辨率和准确度，并具备布鲁克落地式白光干涉 (WLI) 仪器广受业界认可的所有优势，而占地面积更小。该款轮廓仪可轻松自主配置，适用于从精密加工表面和半导体工艺的质量保证/质量控制 (QA/QC) 计量到眼科和机电系统 (MEMS) 器件的研发表征等广泛的复杂应用。



半导体设备

优尼康科技有限公司

3B22

P-7 探针式表面轮廓仪/台阶仪

P-7支持从几纳米到一毫米的台阶高度测量，适用于生产和研发环境。该系统可以对台阶高度、粗糙度、翘曲度和应力进行2D和3D测量，其扫描可达150mm而无需图像拼接。



上海纳腾仪器有限公司

2A130

Profilm 3D光学轮廓仪

Profilm 3D是一款兼具垂直扫描干涉 (VSI) 和高精度相移干涉 (PSI) 技术的经济型光学轮廓仪，其可以用于多种用途的高精度表面测量。其功能主要有用于测量粗糙度、测量曲面样品及多种粗糙度参数标准等。



DYMEK Company Ltd.

3A21

QuickPRO-CUBE非接触式双表面轮廓仪

三维形貌仪通过集成一对单点，非接触式，纳米分辨率的彩色共聚焦传感器与高速，纳米编码的X/Y/Z协调运动，QuickPRO-CUBE™捕获同步的前，后和基准表面3D点云地形，用于托盘中的单镜头或微镜头的几何表征。形式不变运动架构允许测量旋转对称和更复杂的非轴对称或自由形状，最大测量直径为50mm(高达75mm外径)。根据镜头直径和3D点云采样密度的不同，每个镜头每个表面的总测量时间从30秒到240秒不等。



测量仪

思显光电技术（上海）有限公司

3B75

共焦三维轮廓测量仪

通过光谱共焦位移传感器搭载高精度磁驱电动台，扫描三维轮廓。



上海乾曜光学科技有限公司

3C53

FlaTester平面度测量仪

FlaTester平面度测量仪能够快速准确地测量机加工、研磨、抛光和超精密加工的样品表面面形，在几秒钟内非接触地测量零件的整个表面，不同尺寸和复杂形状样品均可测量。FlaTester的分辨率达到5nm，精度为50nm。



微纳科仪（北京）科技有限公司

2A122

Sentronics晶圆测量系统

晶圆厚度测量系统是德国SENTRONICS公司高性能的半导体用半/全自动晶圆厚度测量系统，该系统集成了红外光谱干涉测量技术，光学干涉技术及光学反射技术的测量探头，广泛用于半导体Wafer Manufacturing, FEOL, BEOL 及Wafer Level Packaging领域，SENTRONICS以其精准的测量能力，非接触的测量方式，快速的测试速度，上下双探头符合SEMI标准的测试方式，使得该设备在半导体，MEMS，在化合物外延领域测量晶圆厚度拥有很高的市场占有率。



马波斯（上海）测量设备科技有限公司

3A22

NCG厚度测量仪

NCG测厚仪是一种基于干涉技术的测厚仪，它将反射在被测物体边界层的光波列引入干涉，计算出被测物体的层厚。该测量仪设计用于控制硅片的厚度，也适用于测量其他材料，如玻璃、蓝宝石或任何其他对红外光透明的材料。



固化设备

广州市邦沃电子科技有限公司

1A75

全自动无极灯UV固化设备

邦沃科技研制的全自动无极灯UV固化设备，在线式工作模式，采用全波段无极灯光源，可固化各类UV材料，兼容种类繁多的产品紫外光固化。广泛应用于3C行业，新能源电池生产，PCB三防胶固化，电子半导体，光通信行业，医疗及生物领域，印刷涂敷等各种行业领域。



半导体设备

深圳市海特奈德光电科技有限公司

1C78

自动化UVLED固化设备（显示屏）

自动扫码上传MES系统+UVLED固化+自动检测UV能量+自动上下料+治具回流全自动化，工业4.0对接 防产品漏UV固化 电流检测，能量检测。



深圳市永成光电子股份有限公司

1B23

UVLED固化箱

采用模块式排列方式，主要运用于手机组件、塑胶组件等行业粘合；电子元器件、液晶片、电子胶封胶水固化；光源通常选用365NM，385NM，395NM，405NM等。可进行自由组合各个波长，出光角度、出光距离、出光范围都可以根据客户本身量身定制。UVLED固化系统操作简单即开即亮，省掉待机电量消耗，提高生产效率。光输出稳定均匀，照射均匀效果好。



上海昀通电子科技有限公司

11B63

UVLED固化设备

昀通科技（AVENTK）在UVLED固化领域已有十多年研发生产经验，生产销售产品包括UVLED点光源、面光源、线光源及UVLED固化传送系统，为客户提供全套UVLED固化解决方案。



真空镀膜设备

布勒莱宝光学设备（北京）有限公司

7B51

HELIOS

HELIOS 系列磁控溅射镀膜设备拥有高速稳定的沉积速率、极高的工艺稳定性、高精度的超薄膜厚控制。可用于超过200层和20μm厚的滤光片，具有最优膜层氧化率、高密度、低损耗的特点。可加工的薄膜器件包括激光滤光片、极高陡度截止滤光片、单/多通道负滤光片、激光反射镜、啁啾镜、偏振分光膜、分束镜、环境光传感器、接近光传感器、高光谱成像、手势和面部识别传感器、晶圆级光学、激光雷达传感器等，应用于消费类电子、生命科学、医疗、计量、基础科研等领域。



半导体设备

布勒莱宝光学设备（北京）有限公司

7B51

LEYBOLD OPTICS IBF

LEYBOLD OPTICS IBT 设备是一种生产效率出众的解决方案，它通过自动搬运、批处理和双预抽腔体来对晶圆进行高精度整平和修调。该设备应用于加工射频滤波器调频、石英晶振调频、SOI & POI 衬底表面修调等 MEMS 传感器和硅光子领域。



博顿光电科技有限公司

7B53

IBS离子束溅射镀膜设备

博顿光电自主研发的天玑系列——IBD-XPUTTER 离子束溅射镀膜设备，是一款面向超高精度光电器件制备的高端装备。专注于高质量的光学镀膜，具有极低的散射值和缺陷密度。尺寸、功耗、结构配件均优于其它同类产品，支持多种工艺应用，如相比普通膜制作工艺要求更高的高抗损伤激光膜、超硬超光滑膜等，性能优异，可满足多类行业应用需求。

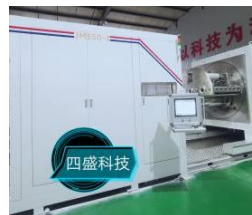


成都四盛科技有限公司

7A55

溅射卷绕镀膜机

四盛科技---卷绕式磁控溅射真空镀膜机：柔性带材卷绕镀膜，独特的单室双主辊设计（满足2种材料的同步溅射），独创8辊同步运行薄膜走向平稳无折皱，且全部采用德国西门子伺服电机+伺服控制器+PLC控制处理，整个卷绕系统采用闭环张力自动控制，磁控靶设有磁场屏蔽板并采用独立的均气环设计，配美国AE电源溅射功率平稳，真空系统全部采用进口泵配置，且溅射区采用独立区域气氛设计抽速可控可调（稳定气流），整机集成优化度高、工控电脑人机界面自动化控制稳定可靠。四盛科技是致力于研发、制造的真空镀膜设备专业制造商。



焊接设备

海目星激光科技集团股份有限公司

2C110

激光锡球焊接机

设备特点：>高效率：焊接速度快，最快0.3S/焊点；>高精度：焊点一致性高，锡球直径为50 μ m~1500 μ m，适用于高精密产品如：CCM摄像头模组、>VCM摄像头马达、FPC连接、金手指、汽车电子、感应器、热敏感元器件、芯片植球、光电子产品；>免清洗：无飞溅，锡球无助焊剂，焊接后免清洗；>安全：激光聚焦光斑小，热影响区域小，能在常规方式不易施焊部位进行加工，无挤压应力，不会损伤工件；>辅助功能：可自动更换喷嘴、自动校准激光、自动擦拭喷嘴。



烟台华创智能装备有限公司

4B210

HC-VS330G型GETTER吸气剂
激活高真空回流焊接系统

HC-VS330G是烟台华创基于多年从事真空回流炉设备设计、制造、工艺和服务经验，隆重推出的一款专用于真空封装的高真空系统。HC-VS330G可以满足MEMS器件如陀螺仪、加速度传感器和红外传感器等在高真空条件下的密封焊接要求，同时实现吸气剂在高真空环境下的热激活和电激活。本系统可以用于科学研究，也可以用于器件的批量生产。



深圳市紫宸激光设备有限公司

2A025

VIL-LWB-CS2

激光锡球焊锡机。主要产品是全系列的激光锡焊设备，广泛应用于电机、光通信器件封装、传感器封装、半导体器件封装、汽车电子、3C电子、精密连接器、医疗器械、PCB印制电路板、精密电子组装等行业。



深圳市顺昱自动化设备有限公司

4D045、4D046

自动超声波铝丝压焊机

自动超声波粗铝丝压焊机CWS3741A，全国首家使用旋转焊头方式，采用数字全自动频率跟踪超声系统，数字控制的压力调节功能，一流的图像识别装置，全闭环的运动控制电路。真正实现了中国粗铝丝键合机全自动化！CWS3741A主要应用于18650特斯拉电池、26800锂电池、IGBT快速恢复模块、汽车电子、激光器器件等焊接。采用先进的图像识别技术和自动寻位技术，实现了焊点的自动、准确定位。强劲富足的数字超声波保证了焊点质量稳定可靠。全自动频率跟踪超声系统及合理的焊头设计保障了焊点的质量。



探针台

深圳市森美协尔科技有限公司

10B28

A系列全自动晶圆探针台

● 可实现12/8/6寸晶圆的WAT和CP测试 ● 微米级全闭环运动控制，实现高精度自动扎针 ● -45到200°C(-55/60到300°C可选)快速控温模式 ● XY最大速度可达250mm/s，测试效率高 ● 自研一体化hinge设计，可接受任意测试机对接。



半导体设备

爱科斯福通信技术（北京）有限公司

10B53

OPAL-MD - 多芯片探针台

在一次自动化测试中对多个切割好的裸片进行表征 完整的 PIC 测试平台，可进行精确、可重复的光学对准和电气探测 利用随附的 PILOT 软件套件进行准备、自动执行（导航、校准、仪器控制）和数据管理（存储、分析 设计灵活，配有可重新定位的光学和电子射频/直流探头 根据需要提供不同的光学探头选项：多达 6 个电动轴，用于单纤或 光纤阵列的表面和边缘耦合。



泰克半导体装备（深圳）有限公司

12B729、12B730

IC探针台

● 高精密丝杆导轨，机械刚性强，使用寿命长，同时与精密光栅尺组合实现运动全闭环控制，具有超高精度的定位精度与长期运行的精密稳定性； ● 整机采用时效处理的铸铁平台与整机下沉式设计，变形量小，机器重量增加，具有极好的运行平稳性； ● 机构尺寸优化缩小，提高厂房利用率； ● 适用于6英寸、8英寸晶圆，包含SIC二极管，三极管、mosfet、垂直结构芯片之测量； ● 多针设计，可实现多颗同时测量之要求，提高机器的测试产能； ● 具有自动清针、自动磨针之功能。

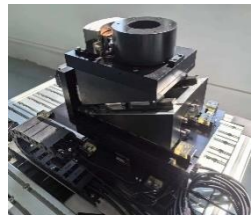


佛山市华道超精科技有限公司

6B99

控制探针台

适用于 5~12英寸集成电路晶圆的自动探针测试。整机特别针对集成电路多芯多探针及高定位 精度的测试需求进行设计，可以满足 1000 根探针以下的单芯或多芯测试，配备全自动上下片系统，具有高精度、高刚性，高稳定性的特点。自动对针提高了对准精度，方便客户多针、多芯测试需要。



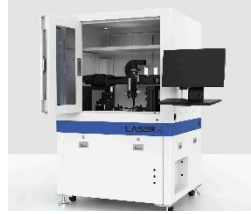
耦合机

镭神技术（深圳）有限公司

10C79

纳米级耦合设备——
单模光路耦合机

作为成熟型的双六轴设备，可为客户提供各种类型的系统配置，适用不同类型的物料耦合；适用耦合类型物料：lens, AWG, FA, Z-Block, 光纤, 准直器等；模块化设计，可根据客户需求提供最佳配置，有效降低生产成本，高精度耦合系统，复定位精度 $\pm 50\text{nm}$ ，能满足高耦合效率的需求，配置图像系统，可多维度定位物料的位置角度，精准对位实现高效耦合；具备自带校准功能，减少人员调试时间和不同人员调试的差异，同时也降低了调试人员的要求。



武汉形识智能科技有限公司

10D77

高速硅光光模块FA
自动耦合设备

高速硅光光模块FA自动耦合设备为400G/800G/1.6T高速光学收发器提供智能自动光学耦合平台，主要用于硅光模块的FA与硅光芯片的自动耦合、自动点胶、自动UV固化功能。具有以下特点：1. 搭配高精度直线电机位移滑台，保证设备运行稳定性 2. 采用自研高精度耦合算法和图像定位算法，有效提升耦合效率及生产效率 3. 具有自动校准功能，有效降低人工依赖性 4. 模块化设计，可快速完成迭代和升级。



半导体设备

中山市思格自动化科技有限公司

10C66

高精度耦合机

中山市思格自动化科技有限公司成立于2019年3月18日，是一家专注于光通讯、半导体、新能源行业的设备研发、制造及销售服务于一体的高科技企业，为客户提供工厂智能化整体解决方案。



东莞普莱信智能技术有限公司

10C71

Lens Bonder高精度
无源耦合机

高精度：精度： $\pm 3\mu\text{m}$ @ 3σ ；角度： $\pm 0.1^\circ$ @ 3σ ；高速度：贴片周期 $\leq 20\text{S}$ （带UV固化）；带UV预固化及自动点胶画胶；独有LENS吸取后的检测功能；高自动化，全自动上下料传输系统，自动玻璃片循环取放测试功能（BMC）等。



耦合机

东莞市耀野自动化有限公司

10C26

透镜耦合机

用于各种高精度透镜（LENS）耦合，XYZ三轴由直线电机+光栅尺组成，分辨率5纳米，重复定位精度20纳米。自动拾取透镜，自动耦合，自动点胶，自动分段UV固化。具备全自动视觉定位，真空机械二合一透镜夹，均为行业先进水平。有伺服电机版的低成本方案供选择。



湖南中南鸿思自动化科技有限公司

10B73

双六轴多通道LENS耦合机

设备功能：全自动化实现LENS与LENS或FA的拾取识别及联合耦合，并自动进行点胶及UV固化。采用高精度的直线电机模组，能满足客户更高耦合精度的需求；点胶及UV组件均设置在思维耦合轴上，简化了结构提高了点胶精度；机器视觉能自动识别PCB芯片和透镜位置和角度，自动进行偏差补偿；配合智能耦合算法，能快速找到最优位，耦合效率高（单路完成时间3-5分钟）。



半导体设备

中山市思格自动化科技有限公司

10C66

高精度耦合机

中山市思格自动化科技有限公司成立于2019年3月18日，是一家专注于光通讯、半导体、新能源行业的设备研发、制造及销售服务于一体的高科技企业，为客户提供工厂智能化整体解决方案。

高精度耦合机
10C66

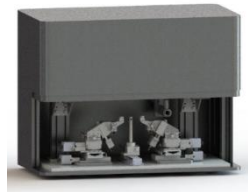


广州敏捷智感光电科技有限公司

6E68

全自动光芯片耦合平台

全自动光芯片耦合平台（型号：ACP-A），实现了光纤与光波导间的全自动耦合封装互连，充分满足光芯片器件的测试评估、波分复用或阵列波导光栅固化封装等需求。该设备通过高精度视觉镜头实现光纤与光波导间粗对准，通过功率优化实现低损耗耦合；使用高性能的自动定位平台，保证实验稳定重复可靠。该设备配套功能强大、操作简单的控制软件，具有自动聚焦、自动对准找光、自动耦合、自动点胶、一键导航、自动测试与记录实验数据等功能，实现了全自动耦合与封装。同时，该控制程序允许用户自定义工艺流程，能满足客户特殊的测试要求。



其他半导体设备

北京科信机电技术研究所有限公司

10C28

FH2021预焊机

技术特点：»适用 2.0×1.6 ~ 13.3×6.5mm 电子元件的预焊。»可定制多种规格工件载盘，在已定义载盘间转换时，相关参数自动切换。»视觉系统实现高精度定位。»具有故障自诊断停机报警功能，显示故障信息。技术参数：»供电电源：单相、220V、800VA »焊接电源：调波、调相焊接电源 »点焊速度：> 2000 只 / 小时 »不合格率：< 3‰



中国电子科技集团公司第二研究所

10D11

平行缝焊机

该设备主要用于微电子器件、光电器件等较大管壳的气密性缝焊。

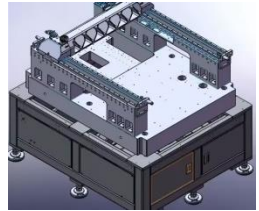


德瑞精工（深圳）有限公司

10C55

大理石双驱龙门平台和
ZR拾取模块

1、高精度大理石平台，应用与半导体高精度行业 2、紧凑型Z+R拾取机构 3、Z轴定位精度2 μ 、重复定位精度 $\pm 0.5\mu$ 4、旋转轴定位精度 $\pm 0.06^\circ$ ，重复定位精度 $\pm 0.005^\circ$ 5、半导体芯片的（开环力控）拾取和贴装、键盘按压测试、触控面板测试、开关检测、液体配剂量/注入、微组装（摄像头模组等微小零件、寿命/疲劳性测试 6、可根据客户需求定制。



锐时科技（北京）有限公司

10C652、10C653

EBPG Plus 高性能电子束曝光系统

EBPG Plus是一种超高性能电子束光刻系统。100kv写入模式和5 nm以下的高分辨率光刻，涵盖了各种纳米制造设备中直接写入纳米光刻、工业研发和批量生产的广泛前沿应用。新系统集成稳定性，保真度和精度于一体，确保最佳的高分辨率光刻结果的所有性能参数之间的完美交互。





重点展示光电子器件

展示范围：光芯片、电芯片

光芯片

西安立芯光电科技有限公司

4B040

850nm 高功率半导体单模激光芯片

850nm单模产品在芯片设计、外延材料生长、前端制备工艺、后端制备工艺、封装测试分析、可靠性与失效分析等六大模块进行了系统性深入研究，突破了芯片研制过程中的诸多关键技术和工艺，成功开发了高功率、高效率和高可靠性单基横模半导体激光芯片系列产品，实现了从外延材料、芯片的完全自主可控。芯片特点：高转换效率、高可靠性、可定制化。

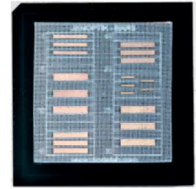


潍坊先进光电芯片研究院

4C165

激光芯片/巴条

激光芯片/巴条 波长范围：7XX、8XX、9XXnm 垂直远场：发散角 $<15^\circ$ 输出功率：100mW~700W 可根据需求定制波长、封装形式。



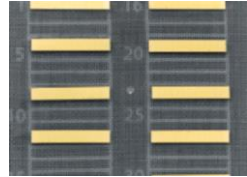
光
电
子
器
件

徐州仟目科技集团有限公司

12A72

高功率巴条激光芯片

公司产品涵盖3D VCSEL芯片、激光雷达芯片、数通VCSEL芯片、大功率激光器芯片，在消费电子、自动驾驶、光纤通讯、工业加工等领域均有广泛应用。



吉光半导体科技有限公司

4A185

高功率半导体激光芯片

高功率半导体激光芯片产品特点:高性能,高电光转换效率,高可靠性。
技术亮点:完全自主外延设计,高质量外延材料生长,特殊工艺技术。



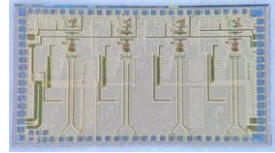
电芯片

杭州芯耘光电科技有限公司

11B21

XY5351/4 & XY53A1/4
线性跨阻放大器

XY5351/4 & XY53A1/4 线性跨阻放大器是覆盖50G~400G应用的高灵敏度、低噪声和高带宽一、四通道线性TIA。它专为 26-53Gbaud PAM4符号率而设计。该芯片提供从 250Ω 到5kΩ可调差分跨阻。带宽可以调整和在噪声和 ISI 之间进行权衡优化接收灵敏度配置。这些TIA 提供反向偏置电压和光电流监视器(RSSI)用于 PIN 光电二极管应用。



芯境科技（上海）有限公司

12C29

光模块DSP芯片

Credo的低功耗、高性能DSP产品拥有业界领先的传输性能，能够为云规模、超大规模和企业级数据中心，以及5G基础设施部署中的50G-400G PAM4光模块提供光互连，功耗及价格极具市场竞争力。产品采用Credo专有的DSP技术和均衡技术有助于补偿光学损伤，以实现最佳的整体系统性能、信号完整性和低功率。Credo光DSP现有单通道100G的Dove和单通道50G的Seagull两个产品系列。其中Seagull全系列可选配支持工温，且已推出集成VCSEL/EML Driver的产品。



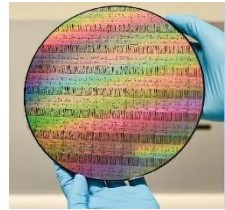
光
电
子
器
件

武汉东隆科技有限公司

10B29

低损耗氮化硅光集成芯片

LIGENTEC (Light GENeration TEchnology)是一家瑞士高端氮化硅芯片研发和制造企业，依托先进而独特的全氮化硅 (AN: All Nitride) 光芯片流片平台。旗舰产品AN800: MPW (多项目晶圆) 提供具有800nm厚度的氮化硅芯片 (AN800)，并对其在近红外波段如C波段的工作性能持续进行优化，保证单模光场被高度限制在氮化硅波导中。根据波导横截面的优化设计，传输损耗保证在0.1~0.2dB/cm以下，本征Q因子在200万以上。

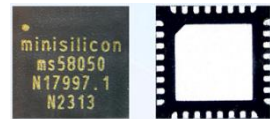


上海米硅科技有限公司

12D53

ms58050/22300-10G单
长距光模块收发芯片组

ms58050是一款集成EML 激光驱动器 (LDD) 和限幅放大器 (LA) 的收发合一芯片，ms22300在ms58050的基础上进一步集成了双向无参考时钟与恢复电路 (CDR)，两款芯片都带有片内的自动功率控制功能 (APC) 以及标准的IIC接口和数字控制电路，可通过标准的IIC接口对芯片的功能及性能进行控制及优化，可搭配米硅10G TIA ms56系列芯片。





重点展示工业传感器

展示范围：工业传感器、MEMS传感器



工业传感器

深圳市通瑞科技有限公司

8D79

电容式角度传感器

电容式角度传感器主要以电编码器专利技术为基础，提出了一个独特和创造性的方法来检测位置，其小型高精度、耐低/高温、真空环境、抗高振动/冲击、低电磁干扰/电磁辐射等特点，已远远超越普通的光电编码器和旋转变压器技术，其独特的优越性已在航空航天、医疗设备、汽车、电子通信等各种应用中展示。

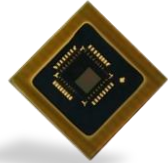


积高电子（无锡）有限公司

6D31

图像传感器

专业从事CMOS图像传感器的PLCC/CLCC/Tiny PLCC/iBGA/3D等，CP测试、研磨、激光开槽、切割、晶圆重组、封装、FT测试。



善测(天津)科技有限公司

6D63

电容传感器

CDU3255是一款单通道高精度电容位移传感器,兼容善测公司所有电容传感器探头型号。设备采用9~36V供电电源,提供模拟量(电流、电压)、数字量输出接口,可进行多台级联同步采集,实现多点高精度位移监测。同时自带显示屏,可实时显示测量结果。便携式的设计和简易的操作性,使其能够进行更多场景的高精度监测。



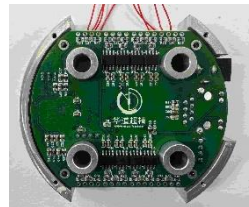
传感器

佛山市华道超精科技有限公司

6B99

六维力传感器

工字柔性铰链 非对称结构,等量程设计一阶测轴力,二阶测扭矩 半解析表达,标定精度高。



MEMS传感器

深圳市美思先端电子有限公司

8B95

红外热电堆阵列传感器

美思先端红外热电堆阵列传感器采用MEMS工艺制造，16X16网格式布局内含有256个热电堆元件，能够在不接触被测物体的前提下探测物体表面的绝对温度，且与CMOS工艺兼容，TO/SMD两种封装形式兼备。

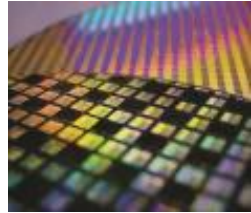
MFrontier 美思先端



苏州工业园区纳米产业技术研究院有限公司 6E35

MEMS晶圆流片代工

MEMS晶圆流片代工，包括硅麦克风、压力传感器、微镜、喷墨头、流量传感器、气体传感器、温度传感器、热电堆、滤波器、铌酸锂光通讯器件、生物芯片、PZT压电器件等。



深圳市英唐极光微技术有限公司

6D24、6D25

MEMS微振镜

一种用于光学扫描的双轴MEMS微振镜。采用MEMS技术在硅衬底上形成镜面，可以通过电磁驱动实现水平扫描和垂直扫描。目前，英唐极光微已有 $\phi 1\text{mm}$ 、 $\phi 1.7/1.8\text{mm}$ 、 $\phi 4\text{mm}$ 、 $\phi 8\text{mm}$ 规格的MEMS微振镜产品。该产品可实现双轴独立驱动，具有FOV广、体积小、低串扰等优势。内置角度和温度传感器，实时反馈数据。经内部验证，此系列产品寿命长，可靠性高，成功通过类车规级可靠性测试。



传感器

武汉利科夫科技有限公司

6B17、6B18

高精度MEMS IMU--
LKF-MG300系列

LKF-MG300系列高精度MEMS惯性测量单元是一款高可靠、高性价比的六轴MEMS惯性传感器组合，可广泛用于以惯性导航、姿态稳定为代表的导航、控制和测量等领域。



*以上所有企业产品及展位号以现场位置为准。

下一站新加坡
NEXT STOP SINGAPORE

APE | Asia Photonics
Expo
亚洲光电博览会



扫码登记参观

2025年2月26-28日

新加坡金沙会议展览中心

26 - 28 FEBRUARY 2025

SANDS EXPO AND CONVENTION CENTRE (MARINA BAY SANDS) LEVEL 1



扫码申请展位

 **CIOE**
中国光博会



CIOE官方微信

2025年9月10-12日

深圳国际会展中心

SEPTEMBER 10 - 12, 2025

SHENZHEN WORLD EXHIBITION & CONVENTION CENTER



展会小程序